股票代碼：4923

力士科技股份有限公司

FORCE MOS TECHNOLOGY CO., LTD.

一一三年度

年報

查詢年報網址：公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)

中華民國一一四年五月十日刊印

一、發言人及代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱：

發言人姓名：鍾秉家
職稱：副總經理
聯絡電話：(02)8976-9223
電子郵件信箱：
rafael@force-mos.com

代理發言人：林祐年
職稱：財會經理
聯絡電話：(02)8976-9223
電子郵件信箱：
anderson @force-mos.com

二、總公司、分公司、工廠之地址及電話：

項目	地址	電話
總公司	新北市新莊區思源路 555 號 24 樓	(02)8976-9223
分公司	無	無
工廠	無	無

三、辦理股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話：

名稱：宏遠證券股份有限公司

地址：台北市信義路 4 段 236 號 3 樓

電話：(02)2326-8818

網址：http://www.honsec.com.tw

四、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：

會計師姓名：寇惠植、李慈慧會計師

事務所名稱：安侯建業聯合會計師事務所

地址：台北市信義路 5 段 7 號 68 樓

電話：(02)8101-6666

網址：http://www.kpmg.com.tw

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢海外有價證券資訊之方式：無。

六、公司網址：http://www.force-mos.com

力士科技股份有限公司

年報目錄

壹、致股東報告書 1

貳、公司治理報告 5

一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料 5
二、最近年度給付董事、總經理及副總經理之酬金 17
三、公司治理運作情形 21
四、會計師公費資訊 48
五、更換會計師資訊 48
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間 48
七、最近年度及截至年報刊印日止董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形 49
八、持股比例占前十大股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係資訊持股比例占前十大股東間互為關係人資料 50
九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例 51

參、募資情形 52

一、資本及股份 52
二、公司債(含海外公司債)辦理情形 55
三、特別股辦理情形 55
四、海外存託憑證之辦理情形 55
五、員工認股權憑證辦理情形 55
六、限制員工權利新股辦理情形 55
七、併購或受讓他公司股份發行新股尚在進行中辦理情形 55
八、資金運用計畫執行情形 55

肆、營運概況 56

一、業務內容 56
二、市場及產銷概況 70
三、最近二年度及截止年報刊印日止從業員工資料 75
四、環保支出資訊 76
五、勞資關係 76

六、資通安全管理.....77
七、重要契約.....79
八、智慧財產權管理計畫與執行成果.....79

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項.....81

一、財務狀況.....81
二、財務績效.....83
三、現金流量.....85
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響.....86
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫.....86
六、風險管理及評估.....86
七、其他重要事項.....90

陸、特別記載事項.....91

一、關係企業相關資料.....91
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形.....91
三、其他必要補充說明事項.....91

柒、最近年度及截至年報刊印日止，如發生本法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項，亦應逐項載明....91

壹、致股東報告書

一一三年度整體消費性電子產品市場緩步回溫，因此，本公司於一一三年度營收小幅成長，然因美國訴訟案件之律師費金額過高，導致一一三年產生虧損。展望未來，預期一一四年整體NB市場將持續溫和成長，加上AI NB之刺激，估計本公司今年出貨可望持續提升、營收增長。本公司在經營策略上積極開發新市場及拓展新客戶，並以既有專利研發新技術與新產品，期能切入藍海市場以避開產品價格競爭，本公司將致力於拓展產品應用層面，提升營運效能，進而維持產品獲利能力，未來仍持續展現研發動能將技術廣泛應用，以提昇公司營業成績。

茲將過去一年來之營運狀況及一一四年度營業計劃概要報告如下：

一、民國一一三年度營業結果

(一)一一三年度營業計畫實施成果

一一三年度全年營收淨額為新台幣815,074仟元，稅前淨損75,035仟元，本期稅後淨損為77,070仟元，每股稅後虧損為2.33元。

(二)預算執行情形、財務收支及獲利能力分析如下：

(1)預算執行情形：本公司一一三年無須編製財務預測。

(2)財務收支分析：

單位：新台幣仟元

項目＼年度	112 年度		113 年度		成長率
	金額	%	金額	%	%
營業收入	738,519	100	815,074	100	10
營業成本	537,536	73	621,139	76	16
營業毛利	200,983	27	193,935	24	-4
營業費用	200,212	27	314,587	39	57
營業淨利	771	-	(120,652)	(15)	-
營業外(損)益	10,517	2	45,617	6	334
稅前淨利	11,288	2	(75,035)	(9)	-
所得稅費用	4,785	1	2,035	-	-57
本期淨利	6,503	1	(77,070)	(9)	-
每股盈餘(虧損)	0.20		(2.33)		

(3)獲利能力：

單位：% 、元

項目＼年度	112 年度	113 年度
資產報酬率（%）	0.73%	-9.12%
股東權益報酬率（%）	0.83%	-13.41%
營業利益占實收資本比率(%)	2.01%	-35.60%
稅前純益占實收資本比率(%)	3.33%	-22.74%
純益率（%）	0.88%	-9.45%
每股盈餘（元）	0.20	(2.33)

(三)業務發展狀況

(1)短期業務發展計劃

A.深入了解客戶設計需求，提供良好客戶產品開發技術諮詢。

B.維持既有客戶之技術與售後服務，保持客戶滿意度。

C.加強研發人力資源，以加快新產品開發時程。

D.強化與各代工廠合作關係，並關注原料廠商，以避免造成銷售缺口。

(2)長期業務發展計劃

A.培養及訓練行銷人員專業素養及產品知識，以拓展客戶與業務範圍。

B.以自有技術為基礎，開發新應用產品，以提高市場佔有率。

C.提供客製化產品，以與客戶緊密結合，提升營收與利潤。

二、民國一一四年度營業計劃概要

(一)經營方針

(1)產品開發計劃

A. 封裝體積縮小及增加散熱片提升效產品效率

電子產品持續朝輕薄短小趨勢發展，對於電源之設計亦是如此，未來在相同甚至更小體積的系統中將需加入更多如視訊、聲音或影像等功能，故相關之電源裝置及電路設計亦須愈小，功能愈強大，產品效能越強，才能配合終端產品之發展趨勢。

B. 高能源轉換效率

對於系統功能要求不斷增加及產品縮小造成的可散熱空間縮小，故在封裝體設計散熱片增加散熱效果，另可攜式產品應用需求興起，低功率損耗解決方案將日形重要，此外功率消耗必需符合綠色環保需求亦為未來發展趨勢。

C. 電源設計符合綠色環保

本公司於 2004 年 12 月底已符合綠色環保之電源設計，目前除了鉛仍舊使用於 IC 製程外，其餘有害化學物質均已全面停用，無滷封裝製程是全球各國對環保、低耗能等綠色概念的要求重點，無鹵封裝製程將

是未來發展主流。

D. 積極研發 Split gate + Super Junction 的新一代 MOSFET 技術
此技術主要應用在中壓的領域，可以縮小 Die size 跟 AC 參數，除了可以降低成本外，也可以應用在快充市場等對於效率要求高的應用。

(2)研究發展計劃：

近年來，由於功率半導體中的重要元件金氧半場效電晶體的市場價格競爭非常激烈，導致產品毛利持續降低。台灣廠商更需不斷地努力積極研發自有技術，方能在國際廠商和大陸廠商的競爭下保持既有的競爭優勢。

溝槽式功率金氧半場效電晶體隨著半導體製程技術之進步，已經精進至 0.18um 製程。力士科技不僅是第一個具有自主性八英吋 0.18um 槽式功率金氧半場效電晶體之半導體製程技術開發和元件設計能力，大大的縮小金氧半場效電晶體積體單元(Unit Cell)面積，可使產品的電氣特性更好和降低產品成本，截至 109 年底止，取得並持續維護中之專利權計 88 項；未來力士科技在提昇功率元件之半導體製程技術和降低產品成本之努力的方向如下：

1. N20~40V 新的 RTG 系列產品持續開展，此技術可降低導通電阻約 25~35%。
2. P20~P40V 持續擴大產品線，以提升晶圓產能及降低成本。
3. ETG1 100V 的製程平台持續往 120V~150V 擴展。
4. ETG2 60V 持續降低單元電晶體尺寸，以降低導通電阻，提升晶片性能及產品競爭力。
5. 尋找適合之晶圓代工廠，合作高壓產品製程開發及元件結構設計。

(二)預計銷售數量及其依據

力士科技是專業功率電力電子元件設計公司，其主要營業項目為溝槽式功率金氧半功率場效電晶體（Power MOSFET）研發設計，廣泛應用於筆記型電腦、液晶電視機、主機板、液晶監視器、鋰電池電源模組、網路/無線通訊、手機、電源供應器、充電器、轉接器、數位相機及可攜式產品、電動車、電動工具、家電等電子或電器產品中之電源和馬達控制系統。

於既有具競爭力之產品及新產品線營收之挹注下，預計銷售情形說明如下：

	114 年度	115 年度	116 年度
Wafer(生產)	38,000 片	40,000 片	42,000 片
IC(生產)	750KK	800KK	850KK
Wafer(銷售)	38,000 片	40,000 片	42,000 片
IC(銷售)	750KK	800KK	850KK

(三)重要產銷政策

在銷售方面，加強研發能量以發展新技術與新產品，並積極開發新市場及拓展新客戶，除此之外，亦強化客戶服務，以提昇市場占有率。

在生產方面，與晶圓及封測代工廠持續維持良好合作關係，並進行專案策略合作，運用封測廠之強項，加強開發新規格或新製程，以提升產品之競爭力。

三、未來公司發展策略

力士科技的未來發展策略主要為下列二點：

(一)深耕市場領域，擴大公司既有的產品平台，並在現有基礎下，積極開發其他種類分離式元件以擴大公司的產品面，提供給客戶更全方面的電源管理方案。

(二)以穩固產品、市場、行銷、技術服務為主軸的核心競爭力持續提昇公司市場價值。

四、受外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

力士科技日常營運均遵照國內外相關法令規定辦理，並隨時注意國內外政策發展趨勢及法規變動情形，蒐集相關資訊提供經營階層決策參考，以調整本公司相關營運策略。

力士科技主要產品係科技產品中最基本且不可或缺的元件，且隨科技進步亦積極不斷研發新規格的產品，以確保其市場競爭優勢，同時掌握產業動態及同業市場訊息，並評估其對公司營運之影響，作相對應之調整，並採行穩健的財務管理策略，以保有市場競爭力。

力士科技時時以新的思維與作為面對總體經濟環境的變化，隨時檢討策略方針，擬訂正確方向且迅速執行，並在經濟景氣有緩步復甦之際，將以企業成長為目標，達成照顧員工，回饋股東的企業使命。

最後，感謝所有股東們長期以來的支持與鼓勵，力士科技全體同仁將本著創新、品質、服務、誠信的經營理念及積極負責的工作態度，持續為股東創造最大的利潤。最後，謹敬祝大家身體健康、萬事如意 ！

董事長：　　總經理：　　會計主管：

貳、公司治理報告

一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

1.董事資料

114 年 3 月 22 日；單位：股；%

職稱(註 1)	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡(註 2)	選(就)任日期	任期	初次選任日期(註 3)	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷(註 4)	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人			備註(註 5)
							股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
董事長	中華民國	鍾明道	男 51~60 歲	113.04.16	3 年	107.06.08	1,497,125	5.99%	2,526,550	7.45%	222,000	0.66%	–	–	崑山工專電子工程科 政大大學經營管理碩士 政治大學資管系博士 力士科技(股)公司董事長 斐成企業(股)公司董事長及總經理 日本松木精密陶瓷株式會社社長	本公司總經理 秉家投資有限公司董事長 宜素投資有限公司董事長 創旭投資有限公司董事	董事兼副總經理	鍾秉家	父子	
董事	中華民國	張晉誠	男 51~60 歲	113.04.16	3 年	105.06.02	242,500	0.97%	291,100	0.86%	240,000	0.71%	–	–	中原大學會計系學士 勤業眾信聯合會計師事務所稅務部協理 斐成企業(股)公司董事	眾嘉聯合會計師事務所主持會計師 力銘科技(股)公司董事 弘高投資有限公司董事 金皇投資有限公司董事 京運開發有限公司董事 泓慶開發有限公司董事 穎崴科技(股)公司獨立董事 永記造漆工業股份有限公司獨立董事 竑騰科技股份有限公司獨立董事	–	–	–	

職稱(註1)	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡 (註2)	選(就)任日期	任期	初次選任日期(註3)	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷(註4)	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人			備註(註5)
							股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
董事	中華民國	廖裕輝	男 71~80 歲	113.04.16	3 年	107.06.08	550,000	2.20%	660,000	1.95%	–	–	–	–	輔仁大學體育系學士 政治大學經營管理碩士	華國大飯店(股)公司董事暨總裁 摩天開發(股)公司董事長 福運投資(股)公司董事長 伸豐達(股)公司董事長 國鼎生物科技(股)公司董事 福炁(股)公司董事 宇泰豐科技實業(股)公司董事長 華國能源(股)公司董事長 森村店工程(股)公司董事長 森村店能源(股)公司董事長 福運能源(股)公司董事長 裕鴻能源(股)公司董事長 英建達(股)公司董事 展輝建設(股)公司董事 上人光電有限公司董事長	–	–	–	
董事	中華民國	涂高維	男 41~50 歲	113.04.16	3 年	110.04.07	30,000	0.12%	36,000	0.11%	–	–	–	–	中原大學電子工程系學士 中正理工學院電子工程碩士 尼克森微電子(股)公司研發部副總經理 無錫華潤芯功率半導體設計有限公司首席設計師和研發副總經理 拓緯實業(股)公司研發總監	本公司技術長				
董事	中華民國	秉家投資有限公司	–	113.04.16	3 年	110.04.07	1,531,000	6.12%	1,837,200	5.42%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	中華民國	代表人：鍾秉家	男 31~40 歲												文藻外語學院西班牙語言科副學士 英國布魯內爾大學品牌與行銷管理碩士 力士科技(股)公司總經理特助	本公司副總經理 馨鼎企業(股)公司董事	董事長兼總經理	鍾明道	父子	

職稱(註1)	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡 (註2)	選(就)任日期	任期	初次選任日期(註3)	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷(註4)	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人			備註(註5)
							股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
獨立董事	中華民國	霍玲玲	女 51~60歲	113.04.16	3年	110.04.07	–	–	–	–	–	–	–	–	中原大學會計系學士 勤業眾信聯合會計師事務所審計及企業諮詢部門領組 法商施耐德電機(股)公司會計經理致和聯合會計師事務所合夥會計師 力士科技(股)公司監察人	信群會計師事務所所長 金石企管顧問(股)公司董事長 微創顧問(股)公司監察人 佑佳投資有限公司董事長 永祿投資有限公司董事長	–	–	–	
獨立董事	中華民國	謝美姿	女 51~60歲	113.04.16	3年	113.04.16	–	–	–	–	–	–	–	–	中原大學會計系 上海財經大學工商管理碩士 明碁電腦(股)公司會計管理師 資誠聯合會計師事務所高級審計員 兆順聯合會計師事務所合夥會計師 長榮聯合會計師事務所合夥會計師	經典聯合會計師事務所會計師 偉林電子股份有限公司監察人 高和益生股份有限公司監察人	–	–	–	
獨立董事	中華民國	陳夢萍	女 51~60歲	113.04.16	3年	113.04.16	–	–	–	–	–	–	–	–	中國文化大學會計系 安侯建業會計師事務所經理	當代會計師事務所會計師 台灣表面黏著科技(股)獨立董事	–	–	–	
獨立董事	中華民國	孫德至 (註6)	男 41~50歲	113.04.16	3年	107.08.16	–	–	–	–	–	–	–	–	臺灣大學法律系學士 臺灣大學法學碩士 美國哥倫比亞大學法學碩士 眾達國際法律事務所律師	創拓國際法律事務所主持律師 創拓國際顧問股份有限公司董事 安馳科技(股)公司獨立董事	–	–	–	

註1：法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示(屬法人股東代表者，應註明法人股東名稱)，並應填列下表一。
註2：請列示實際年齡，並得採區間方式表達，如41~50歲或51~60歲。
註3：填列首次擔任公司董事或監察人之時間，如有中斷情事，應附註說明。
註4：與擔任目前職位相關之經歷，如於前揭期間曾於查核簽證會計師事務所或關係企業任職，應敘明其擔任之職稱及負責之職務。
註5：公司董事長與總經理或相當職務者(最高經理人)為同一人、互為配偶或一親等親屬者，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施(例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊。
註6：孫德至獨立董事於113年5月21日辭任。

(1)法人股東之主要股東

法人股東名稱	法人股東之主要股東
秉家投資有限公司	鍾明道 (16.66%) 鍾秉家 (16.66%) 鍾秉寰 (16.66%) 林宣妤 (16.66%) 鍾慧華 (16.66%) 鍾何素琴(16.66%)

主要股東為法人者其主要股東：無

2.董事所具專業知識及獨立性情形

條件 姓名	專業資格與經驗(註 1)	獨立性情形(註 2)	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
鍾明道	畢業於政治大學資管系博士，具有五年以上商務、財務及公司業務所須之工作經驗，目前擔任本公司總經理。	未有公司法第 30 條各款情事之一	0
張晋誠	畢業於中原大會計系，具有五年以上商務、財務、會計及公司業務所須之工作經驗，目前擔任本公司董事長暨眾嘉聯合會計師事務所主持會計師。	未有公司法第 30 條各款情事之一	3
廖裕輝	畢業於政治大學商學院經營管理組碩士，具有五年以上商務、財務及公司業務所須之工作經驗，目前擔任華國大飯店股份有限公司總裁。	未有公司法第 30 條各款情事之一	0
涂高維	畢業於中正理工學院電子工程碩士，具有五年以上公司業務所須之工作經驗，目前擔任本公司技術長。	未有公司法第 30 條各款情事之一	0
秉家投資有限公司代表人：鍾秉家	畢業於英國布魯內爾大學品牌與行銷管理碩士，具有五年以上公司業務所須之工作經驗，目前擔任本公司副總經理。	未有公司法第 30 條各款情事之一	0

條件 姓名	專業資格與經驗(註 1)	獨立性情形(註 2)	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
霍玲玲	畢業於中原大會計系，具有五年以上商務、財務、會計及公司業務所須之工作經驗，目前擔任信群會計師事務所所長。	(1)非本公司或其關係企業之受僱人。 (2)非本公司或其關係企業之董事、監察人。 (3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數 1%以上或持股前十名之自然人股東。 (4)非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。 (5)非直接持有本公司已發行股份總數 5%以上、持股前五名或依公司法第 27 條第 1 項或第 2 項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人。 (6)非與本公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人。 (7)非與本公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監	0
謝美姿	畢業於中原大會計系及上海財經大學工商管理碩士，具有五年以上商務、財務、會計及公司業務所須之工作經驗，目前擔任經典聯合會計師事務所會計師。		0

條件 姓名	專業資格與經驗(註 1)	獨立性情形(註 2)	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
陳夢萍	畢業於中國文化大學會計系，具有五年以上商務、財務、會計及公司業務所須之工作經驗，目前擔任當代會計師事務所會計師。	察人(監事)或受僱人。 (8)非與本公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股 5%以上股東。 (9)非為本公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。 (10)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 (11)未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。 (12) 未有公司法第 30 條各款情事之一。	1

註：董事會多元化及獨立性：

(一)董事會多元化：

本公司公司治理實務守則訂有董事會組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

二、專業知識與技能：專業背景如法律、會計、產業、財務、行銷或科技、專業技能及產業經歷等。董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

(1) 營運判斷能力。

(2) 會計及財務分析能力。

(3) 經營管理能力。
(4) 危機處理能力。
(5) 產業知識。
(6) 國際市場觀。
(7) 領導能力。
(8) 決策能力。

董事會成員多元化情形

多元化項目 / 姓名	性別	兼任本公司員工	基本組成							多元化專業及產業經驗							
			年齡					獨立董事任期年資									
			31至40歲	41至50歲	51至60歲	61至70歲	71至80歲	3年以下	3至9年	營運判斷能力	會計及財務分析能力	經營管理能力	危機處理能力	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力
鍾明道	男				V					V	V	V	V	V	V	V	V
張晉誠	男	V			V					V	V	V	V	V	V	V	V
廖裕輝	男						V			V		V	V		V	V	V
涂高維	男	V		V						V		V	V	V	V	V	V
秉家投資有限公司 代表人：鍾秉家	男	V	V							V		V	V	V	V	V	V
霍玲玲	女				V				V	V	V	V	V		V	V	V
謝美姿	女				V			V		V	V	V	V		V	V	V
陳夢萍	女				V			V		V	V	V	V		V	V	V

管理目標與目前達成情形：

公司董事成員目前已達成任一性別董事達三分之一之多元化要求，惟為配合未來的發展需要，將持續檢視多元化的組成要件，於改選時持續強化董事會成員多元化的目標。本公司具體管理目標為逐步增加董事會成員具有公司治理、環境永續、企業社會責任相關方面觀念及背景，以更能監督和指導公司因應國際發展趨勢。

(二)董事會獨立性：

本公司董事會由8位董事組成，包含3位獨立董事，獨立董事人數占全體董事席次37.5%，因113年一席獨立董事辭任，本次股東會將補選之。本公司董事間不超過二人具有配偶或二親等以內之親屬關係，亦無證交法第26 條之3 第3 項及第4 項規定之情事。本公司董事會首要責任是監督公司守法、財務透明、即時揭露重要訊息，及對公司財務業務能做出客觀獨立之判斷，因此在選任時即已符合法令之要求。

(三)董事會成員及重要管理階層之接班規劃：

董事會成員之接班計畫及運作：

♦本公司董事選任係依據「公司章程」採候選人提名制度，每屆任期三年，同時參酌每年董事會成員之績效評估結果作為遴選或提名董事之參考依據，再依循「公司治理實務守則」明定之董事會成員組成應考量多元化，並就公司本身運作、營運型態及發展需求等擬訂多元化方針，包括但不限於基本條件(性別、年齡等)與價值、專業知識技能等兩大面向之標準。

♦本公司之董事會結構，應就公司經營發展規模及主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，決定適當董事席次。

♦本公司持續進行之董事繼任計畫，以下列標準建置董事人選資料庫：

(1)誠信、負責、創新及決策力。

(2)與本公司核心價值相符具備有助於公司經營管理的專業知識與技能。

(3)具有與本公司所營業務相關的產業經驗。

(4)能為公司持續提供有效、協同、多元性的董事會。

(5)整體董事會專長面向需包含企業策略與管理、會計與稅務、財務金融、法律。

(6)訂定董事候選人名單甄選過程皆須符合資格審查與相關規範，以確保當董事席次產生空缺或規劃增加時，能有效鑑別選出合適的新任董事人選。

♦為促使董事持續提升其能力，本公司每年皆安排6小時以上之董事進修課程以輔助董事獲取新知、與時俱進，並熟悉自身在董事會的角色、功能、責任及義務，有效落實公司治理制度，並有利於延續優化董事會，達成企業永續經營。

♦本公司明定「董事會績效評估辦法」，藉由績效評估之衡量項目，包括公司目標與任務之掌控、職責認知、營運之參與、內部關係經營與溝通、專業職能與進修、內部控制及具體意見表述等，以確認董事會運作有效，與評定董事績效表現，以作為日後遴選董事之參考。

重要管理階層之接班計畫及運作：

♦本公司為IC設計公司，人員精簡，經理級(含)以上員工即為重要管理階層，負責各部門內相關專業領域之經營管理業務。

♦重要管理階層除須具備必要之專業技能及經歷背景外，並能洞悉產業變化且及時應變外，更重要的是其價值觀應與公司的企業文化與經營理念契合。

♦重要管理階層及其職務代理人之培訓計畫，除規劃專業訓練等課程，以強化管理階層之專業外，同時鼓勵其參與諸如公司治理等外部訓練課程，也安排參與內部經營管理會議，更於適當時機委以專案任務以進行在職訓練。此外，各職務代理人或潛在接班人選，除了透過教育訓練實體課程的安排，亦透過工作輪調、一對一的經驗傳授與指導，以提升經營管理能力與思維。

♦本公司每年執行員工績效考核，透過該管主管平日觀察及績效評估，了解各員工個人發展需求、應加強之領域等，以歷次考核結果作為日後接班規劃之參考。

3.總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管

114年3月22日；單位：股；%

職稱	姓名	性別	國籍	就任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			經理人取得員工認股權憑證情形	備註
					股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係		
董事長兼總經理暨技術行銷處處長	鍾明道	男	中華民國	107.03.15	2,526,550	7.45%	222,000	0.66%	–	–	崑山工專電子工程科 政治大學經營管理碩士 政治大學資管系博士 力士科技(股)公司董事長 斐成企業(股)公司董事長及總經理 日本松木精密陶瓷株式會社社長	秉家投資有限公司董事長 宜素投資有限公司董事長 創旭投資有限公司董事	副總經理	鍾秉家	父子	–	
副總經理暨採購處處長	鍾秉家	男	中華民國	107.12.25	1,050,990	3.10%	–	–	–	–	文藻外語學院西班牙語言科 英國布魯內爾大學品牌與行銷管理碩士 力士科技(股)公司總經理特助	馨鼎企業(股)公司董事	總經理	鍾明道	父子	–	
技術長	涂高維	男	中華民國	107.12.25	36,000	0.11%	–	–	–	–	中原大學電子工程系學士 中正理工學院電子工程研究所碩士 尼克森微電子(股)公司研發部副總經理 無錫華潤芯功率半導體設計有限公司首席設計師和研發副總經理 拓緯實業(股)公司研發總監	–	–	–	–	–	
研發處處長暨產品處處長	張淵舜	男	中華民國	108.12.24	-	-	–	–	–	–	長庚大學電子工程學系學士 長庚大學電子工程學系碩士 力祥半導體(股)公司研發部經理 拓緯實業(股)公司研發總監	–	–	–	–	–	
管理處代處長暨財	林祐年	男	中華民國	106.06.08	86,550	0.26%	–	–	–	–	東吳大學會計系學士 澳洲雪梨大學工商管理碩士	–	–	–	–	–	

職稱	姓名	性別	國籍	就任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			經理人取得員工認股權憑證情形	備註
					股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係		
會部經理											安侯建業聯合會計師事務所審計部經理 元大京華證券(股)公司(現為元大證券(股)公司)承銷部高等專員						
稽核主管	黃俊傑	男	中華民國	103.12.15	13,200	0.04%	–	–	–	–	中原大學會計系學士 東友科技(股)公司財會處副處長 精碟科技(股)公司會計資深協理	–	–	–	–	–	
營運處資深處長	曾振益	男	中華民國	111.11.02	–	–	–	–	–	–	台灣科技大學電子工程系學士 力士科技有限公司營運處處長 MaxLinear Inc. Director of Products Operation 德信科技有限公司營運處協理	–	–	–	–	–	
品保處處長	呂宏松	男	中華民國	113.01.17	1,000	0.003%	–	–	–	–	台北科技大學工業工程與管理系學士 倚天資訊工程師 斐成企業股份有限公司副理 松木高分子科技股份有限公司資深經理	–	–	–	–	–	

二、最近年度給付董事、總經理及副總經理之酬金

1.113年度支付一般董事及獨立董事之酬金（彙總配合級距揭露姓名及酬金方式）：

單位：新臺幣千元

職稱	姓名	董事酬金								A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(註10)		兼任員工領取相關酬金								A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例(註10)		來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金(註11)
		報酬(A)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)		業務執行費用(D)				薪資、獎金及特支費等(E)		退職退休金(F)		員工酬勞(G)						
																本公司		財務報告內所有公司				
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額	本公司	財務報告內所有公司	
董事長	張晉誠	1,058	1,058	0	0	0	0	107	107	-1.51	-1.51	9.656	9.656	265	265	0	0	0	0	-14.38	-14.38	無
董事	鍾明道																					
董事	林才熙																					
董事	廖裕輝																					
董事	秉家投資有限公司 代表人：鍾秉家																					
董事	涂高維																					
獨立董事	趙培宏	928	928	0	0	0	0	65	65	-1.29	-1.29	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.29	-1.29	無
獨立董事	霍玲玲																					
獨立董事	孫德至																					
獨立董事	謝美姿																					
獨立董事	陳夢萍																					

1. 請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：公司章程授權董事會決議獨立董事(含薪酬委員薪酬)每年支領新台幣30萬元。
2. 除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務(如擔任非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。

酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名			
	前四項酬金總額(A+B+C+D)		前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)	
	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司
低於 1,000,000 元	鍾明道、張晉誠、林才熙、廖裕輝、秉家投資有限公司代表人：鍾秉家、涂高維，獨立董事：趙培宏、霍玲玲、孫德至、謝美姿、陳夢萍	鍾明道、張晉誠、林才熙、廖裕輝、秉家投資有限公司代表人：鍾秉家、涂高維，獨立董事：趙培宏、霍玲玲、孫德至、謝美姿、陳夢萍	張晉誠、林才熙、廖裕輝，獨立董事：趙培宏、霍玲玲、孫德至、謝美姿、陳夢萍	張晉誠、林才熙、廖裕輝，獨立董事：趙培宏、霍玲玲、孫德至、謝美姿、陳夢萍
1,000,000 元(含）～2,000,000 元(不含)	-	-	-	-
2,000,000 元（含）～3,500,000 元（不含）	-	-	鍾明道、秉家投資有限公司代表人：鍾秉家	鍾明道、秉家投資有限公司代表人：鍾秉家
3,500,000 元（含）～5,000,000 元（不含）	-	-	涂高維	涂高維
5,000,000 元（含）～10,000,000 元（不含）	-	-	-	-
10,000,000 元（含）～15,000,000 元（不含）	-	-	-	-
15,000,000 元（含）～30,000,000 元（不含）	-	-	-	-
30,000,000 元（含）～50,000,000 元（不含）	-	-	-	-
50,000,000 元（含）～100,000,000 元（不含）	-	-	-	-
100,000,000 元以上	-	-	-	-
總計	11 名	11 名	11 名	11 名

2.113年度支付監察人之酬金（彙總配合級距揭露姓名及酬金方式）：本公司係設置審計委員會取代監察人制度，故不適用。

3.113年度給付總經理及副總經理之酬金（彙總配合級距揭露姓名及酬金方式）

單位：新臺幣千元

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)(註 1)		獎金及特支費等等(C)		員工酬勞金額(D)				A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例（%）（註 8）		有無領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金
								本公司		財務報告內所有公司				
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額	本公司	財務報告內所有公司	
總經理	鍾明道	8,781	8,781	265	265	875	875	0	0	0	0	-12.88	-12.88	-
副總經理	鍾秉家													
技術長	涂高維													

(註 1)：退職退休金係依勞基法提撥退休金專戶。

酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司	財務報告內所有公司
低於 1,000,000 元	–	–
1,000,000 元(含）～2,000,000 元(不含)		
2,000,000 元（含）～3,500,000 元（不含）	鍾明道、鍾秉家	鍾明道、鍾秉家
3,500,000 元（含）～5,000,000 元（不含）	涂高維	涂高維
5,000,000 元（含）～10,000,000 元（不含）	–	–
10,000,000 元（含）～15,000,000 元（不含）	–	–
15,000,000 元（含）～30,000,000 元（不含）	–	–
30,000,000 元（含）～50,000,000 元（不含）	–	–
50,000,000 元（含）～100,000,000 元（不含）	–	–
100,000,000 元以上	–	–
總計	3 名	3 名

4.分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形：

114 年 3 月 22 日/單位:新台幣千元

	職稱	姓名	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純益之比例（%）
經理人	總經理	鍾明道	-	-	-	-
	副總經理	鍾秉家				
	技術長	涂高維				
	研發處處長	張淵舜				
	營運處資深處長	曾振益				
	品保處處長	呂宏松				
	財會部經理	林祐年				

5.分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性：

(1)最近二年度支付本公司董事、總經理及副總經理酬金總額佔稅後純益比例之分析

單位：%

項目	113 年度		112 年度	
	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司
董事酬金	-2.80	-2.80	36.71	36.71
總經理及副總經理酬金	-12.87	-12.87	134.61	134.61

(2)給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效及未來風險之關聯性

A.董事：本公司支付予董事之酬金係依據本公司章程與「董事及經理人薪酬辦法」規定辦理定，年度如有獲利由薪資報酬委員會依據章程規定之成數向董事會提出建議，董事會通過後並於股東會報告。

B.總經理及副總經理：本公司支付予總經理、副總經理之酬金包含薪資、獎金及員工酬勞，係根據其所擔任之職位、承擔之責任、對本公司之績效及參考市場行情所訂定，由薪資報酬委員會向董事會建議後並由董事會決議；員工酬勞係由薪資報酬委員會依據公司章程規定，年度如有獲利依據章程規定之成數向董事會提出建議，董事會通過後並於股東會報告。

C.本公司董事會設置薪資報酬委員會，協助董事會訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構以及定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

D.未來風險：本公司未來仍將按照公司章程與「董事及經理人薪酬辦法」規定、參考市場行情並依據各董事及經理人對公司貢獻程度，併同考量公司未來面臨之營運風險及經營績效之正向關聯性，以謀求永續經營與風險控管之平衡。

三、公司治理運作情形：

1.董事會運作情形：

本公司 113 年度董事會開會 7 次(A)，董事出列席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數	委託出席次數	實際出(列)席率(%)	備註
董事長	鍾明道	7	0	100.00	
董事	張晉誠	7	0	100.00	
董事	林才熙	2	0	100.00	註 1
董事	廖裕輝	6	1	85.71	
董事	涂高維	7	0	100.00	
董事	秉家投資有限公司 代表人：鍾秉家	7	0	100.00	
獨立董事	霍玲玲	7	0	100.00	
獨立董事	謝美姿	5	0	100.00	註 1
獨立董事	陳夢萍	5	0	100.00	註 1
獨立董事	孫德至	3	0	75.00	註 2

註 1：本公司於 113 年 4 月 16 日股東常會全面改選董事。

註 2：孫德至獨立董事於 113 年 5 月 21 日辭任。

其他應記載事項：

一、董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會召開日期、期別、議案內容、獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理。

(一)證券交易法第 14 條之 3 所列事項：無此情形。

(二)除前開事項外，其他未經董事會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無此情形。

二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：

會議日期	董事姓名	議案內容	應利益迴避原因	參與表決情形
113/1/17 第七屆 第十八次	鍾明道 涂高維 鍾秉家 廖裕輝	**發放績效獎金案**	董事鍾明道、涂高維及鍾秉家兼任經理人為本案利害關係人，董事廖裕輝委託董事鍾明道代理。	依法迴避本案之討論及表決
113/5/10 第八屆 第二次	鍾明道 涂高維 鍾秉家	**發放端午節獎金案**	董事鍾明道、涂高維及鍾秉家兼任經理人為本案利害關係人。	依法迴避本案之討論及表決
	霍玲玲 謝美姿 陳夢萍	委任本公司第六屆薪資報酬委員會委員案	**獨立董事霍玲玲**、獨立董事謝美姿及獨立董事陳夢萍為本案利害關係人。	依法迴避本案之討論及表決
113/8/6 第八屆 第三次	張晉誠 鍾明道 涂高維 鍾秉家 廖裕輝	**一一二年度董事酬勞發放案**	董事長鍾明道、董事張晉誠、涂高維、廖裕輝及鍾秉家為本案利害關係人。	依法迴避本案之討論及表決

	鍾明道 涂高維 鍾秉家	**一一二年度經理人員工酬勞發放案**	董事長鍾明道、董事涂高維及鍾秉家兼任經理人為本案利害關係人。	依法迴避本案之討論及表決
	涂高維	**薪資報酬調整案**	董事長鍾明道、董事涂高維及鍾秉家兼任經理人為本案利害關係人。	依法迴避本案之討論及表決
113/12/27 第八屆 第五次	鍾明道 涂高維 鍾秉家	**發放績效獎金案**	董事長鍾明道、董事涂高維及鍾秉家兼任經理人為本案利害關係人。	依法迴避本案之討論及表決
	涂高維 鍾秉家	**發放專利申請及獲證獎金案**	董事涂高維及鍾秉家兼任經理人為本案利害關係人。	依法迴避本案之討論及表決

三、上市上櫃公司應揭露董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊，並填列董事會評鑑執行情形：

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行一次	113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日	董事會、個別董事成員及功能性委員會	董事會內部自評、董事成員自評	對公司營運之參與程度、董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制等

四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）與執行情形評估：

(1)加強職能部分：

(A)本公司已訂定「董事會議事規則」，董事會運作皆依循辦理。

(B)本公司已於105年設置「審計委員會」，以提升公司治理效能。

(2)提升資訊透明度部分：本公司設有發言人及代理發言人，並有專人負責公開資訊揭露等相關事宜，投資大眾均可即時獲得資訊。

2.最近年度(113 年度)審計委員會開會 7 次（A），獨立董事出列席情形如下：

職稱	姓名	實際列席次數	實際出(列)席率(%)	備註
獨立董事	趙培宏	2	100.00	113 年 4 月 16 日卸任
獨立董事	孫德至	3	75.00	113 年 5 月 21 日辭任
獨立董事	霍玲玲	7	100.00	113 年 4 月 16 日續任
獨立董事	謝美姿	5	100.00	113 年 4 月 16 日就任
獨立董事	陳夢萍	5	100.00	113 年 4 月 16 日就任

其他應記載事項：

一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。

(一)證券交易法第 14 條之 5 所列事項：

董事會期別(日期)	議案內容	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理
第七屆第十八次董事會(113/01/17)	1. 民國一一三年度營業預算案。	全體審計委員無異議通過	不適用
第七屆第十九次董事會(113/03/01)	1.出具民國一一二年度「內部控制制度聲明書」案。 2.承認民國一一二年度營業報告書及財務報表案。 3.民國一一二年度盈餘分配案。 4 以資本公積發放現金股利案。 5.評估簽證會計師獨立性及適任性案。	全體審計委員無異議通過	不適用
第八屆第二次董事會(113/05/10)	1. 承認一一三年第一季財務報告案。	全體審計委員無異議通過	不適用
第八屆第三次董事會(113/08/06)	1. 承認一一三年第二季財務報告案。 2. 買回本公司已發行股份轉讓予員工案	全體審計委員無異議通過	不適用
第八屆第四次董事會(113/11/05)	1. 承認一一二年第三季財務報告案。	全體審計委員無異議通過	不適用
第八屆第五次董事會(113/12/27)	1. 民國一一四年度稽核計畫案。 2. 民國一一四年度營業預算案	全體審計委員無異議通過	不適用

(二)除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無此情形。

二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無。

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等）：

1. 內部稽核部門除每月將稽核報告送交獨立董事審核外，稽核主管亦針對稽核重大發現於董事會上向各獨立董事及董事會成員提出報告。
2. 獨立董事與會計師溝通情形：獨立董事不定期與會計師針對本公司財務業務進行溝通了解，如有重大財務業務事項，亦與會計師以書面或會面方式溝通。

監察人參與董事會運作情形資訊：本公司於 105 年 6 月 2 日股東常會通過設置審計委員會，故不適用。

3.公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形			差異情形及原因差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？	✓		本公司已訂定「公司治理實務守則」及完備之內部控制制度、內部稽核制度並已有效執行，符合公司治理實務守則運作。	無重大差異
二、公司股權結構及股東權益 （一）公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？ （二）公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？ （三）公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？ （四）公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	 ✓ ✓ ✓ ✓		(一) 本公司設有發言人、代理發言人等專責人員，並訂有「股東會議事規則」處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜。 (二) 本公司依證交法第25條規定，對內部人，包括董事、監察人、經理人及股份超過10%之股東，所持股權之變動情形，均按月於公開資訊觀測站網站申報。 (三) 本公司訂有「集團企業、特定公司及關係人財務業務往來辦法」及「關係人交易之管理辦法」，本公司目前無其他關係企業。 (四) 本公司訂有「防範內線交易管理辦法」、「道德行為準則」及「工作規則」，並經董事會核定施。	尚無重大差異

三、董事會之組成及職責 （一）董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？ （二）公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？ （三）公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？ （四）公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	✓ ✓ ✓ ✓		(一) 本公司董事之選任，乃考量董事會之整體配置，董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、經驗、技能及素養已明定於「董事及監察人選任程序」中，董事會成員均在各領域有所專長，均能就公司營運提出卓見。 (二) 本公司目前尚無計畫增設其他類功能性委員會，未來視實際需要斟酌辦理。 (三) 本公司「董事會績效評估辦法及程序」訂有董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估。 (四) 本公司董事會均定期評估本公司簽證會計師之獨立性。	
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？		✓	本公司設置公司治理主管一人，兼任財務會計相關業務；本公司議事單位由公司治理主管負責，其依法辦理董事會、功能性委員會及股東會之會議相關事宜及製作董事會及股東會議事錄等，致力強化本公司公司治理制度。本公司之公司登記及變更登記由股務人員負責。	未來本公司將視公司經營狀況，適時引入具備專才協助公司治理相關事務。
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	✓		本公司除網站設置專區列示聯繫管道外，並設有發言人及代理發言人制度，妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題。	無重大差異
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	✓		本公司委任宏遠證券股份有限公司代辦股東會事宜。	無重大差異

七、資訊公開 （一）公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？ （二）公司是否採行其他資訊揭露之方式（如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等）？ （三）公司是否於會計年度終了後二個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？	✓ ✓ ✓		(一)本公司網站已建置專區，且依規定定期及不定期於公開資訊觀測站申報各項財務、業務等資訊。。 (二)公司有專責單位負責揭露資訊的蒐集及揭露，並設有發言人及代理發言人，落實發言人制度。 (三)本公司由專責人員按時公告第一、二、三季及年度財務報告及每月營運情形。	與治理實務守則規定相符。 無重大差異
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等）？	✓		(一)本公司訂有「企業社會責任實務守則」，並通過ISO9001，對落實公司治理、發展永續環境、維護社會公益、加強企業社會責任資訊揭露等持續推動。 (二)本公司董事均不定期參加財務、業務等專業知識進修課程。 (三)有關員工權益，本公司除依各項法令規範辦理外，另訂有各項福利措施、進修訓練等。 (四)本公司與合作廠商配合，均依契約履約執行，供應商並簽有「歐盟限制使用物質(RoHS)不使用保證書」。 (五)本公司已為全體董事購買董事責任保險，以強化股東權益之保障。	無重大差異
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施：				

(一)依據112年度第十屆公司治理評鑑結果，已改善情形如下：

項次	評鑑指標	改善情形
1	公司是否訂定董事會成員多元化之政策，並將多元化政策之具體管理目標與落實情形揭露於公司網站及年報？	已訂定董事會成員多元化之政策，並將落實情形揭露於公司網站
項次	評鑑指標	改善情形
2	公司是否揭露審計委員會成員專業資格與經驗、年度工作重點及運作情形？	已將審計委員會成員專業資格與經驗、年度工作重點及運作情形揭露於公司網站
3	公司之公司治理主管是否為專任，並於公司網站及年報說明職權範圍及進修情形？	本公司公司治理主管為專任，並已將於公司網站說明職權範圍及進修情形
4	公司網站是否揭露包含財務、業務及公司治理之相關資訊？	已將公司財務、業務及公司治理之相關資訊揭露於公司網站
5	公司是否獲得ISO 14001、ISO50001或類似之環境或能源管理系統驗證？	本公司已獲得ISO 14001認證
6	公司網站或年報是否揭露經董事會通過之誠信經營政策，明訂具體作法與防範不誠信行為方案，並說明履行情形?	已將誠信經營政策之具體作法與執行情形揭露於公司網站
7	公司是否於股東常會議事錄記載股東提問及公司回覆之重要內容?	股東常會之股東提問及公司回覆之重要內容已記載於議事錄

(二)依據112年度第十屆公司治理評鑑結果，就尚未改善者提出優先加強事項與措施如下：

項次	評鑑指標	優先加強事項與措施
1	公司是否於股東常會開會30日前上傳英文版開會通知、議事手冊及會議補充資料？	將於114年提供英文版開會通知、議事手冊及會議補充資料
2	公司是否於股東常會開會30日前上傳股東會議事手冊及會議補充資料？	將於114年按時上傳股東會議事手冊及會議補充資料
3	公司是否於股東常會開會18日前上傳年報？	將於114年按時上傳年報

項次	評鑑指標	優先加強事項與措施
4	公司是否於股東常會開會16日前上傳英文版年報？	將於114年提供英文版年報
5	公司年報是否揭露前一年度股東常會決議事項之執行情形？	將於114年揭露前一年度股東常會決議事項之執行情形
6	公司是否制訂與營運目標連結之智慧財產管理計畫，並於公司網站或年報揭露執行情形，且至少一年一次向董事會報告？	已於113年向董事會報告與營運目標連結之智慧財產管理計畫及執行情形，並於114年揭露於年報
7	公司是否在會計年度結束後兩個月內公布經會計師查核簽證之年度財務報告？	114年將於二月底前公布經會計師查核簽證之年度財務報告
8	公司是否於中文版期中財務報告申報期限後兩個月內以英文揭露期中財務報告？	將於114年提供英文版期中財務報告
9	公司是否設置推動企業誠信經營專（兼）職單位，負責誠信經營政策與防範方案之制訂及監督執行，並於公司網站及年報說明設置單位之運作及執行情形，且至少一年一次向董事會報告？	已於113年向董事會報告企業誠信經營專（兼）職單位，及誠信經營政策與防範方案之制訂與執行情形，並於114年揭露於年報
10	公司網站及年報是否揭露各項員工福利措施、退休制度與其實施情形?	將於114年揭露各項員工福利措施、退休制度與其實施情形

(三)公司治理主管職權範圍及進修情形

本公司經 2021 年 8 月 4 日董事會決議通過，指定林祐年財會經理擔任公司治理主管，保障股東權益並強化董事會職能，林祐年財會經理已具備公開發行公司從事財務之主管職務經驗達三年以上。

公司治理主管主要職責為依法辦理董事會及股東會會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令等。

● 公司治理主管進修情形：

進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
2024.09.20	財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心	上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會	3
2024.10.29~2024.10.30	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務研習班	12

4.公司如有設置薪酬委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形：

(1)薪資報酬委員會成員資料：

<table>
<tr><th colspan="2">條件
身分別
(註1)
姓名</th><th>專業資格與經驗</th><th>獨立性情形</th><th>兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數</th></tr>
<tr><td>召集人</td><td>霍玲玲</td><td>畢業於中原大會計系，具有五年以上商務、財務、會計及公司業務所須之工作經驗，目前擔任信群會計師事務所所長。</td><td rowspan="3">(1)非本公司或其關係企業之受僱人。
(2)非本公司或其關係企業之董事、監察人。
(3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數1%以上或持股前十名之自然人股東。
(4)非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
(5)非直接持有本公司已發行股份總數5%以上、持股前五名或依公司法第27 條第1 項或第2 項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人。
(6)非與本公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人。
(7)非與本公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人。
(8)非與本公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股5%以上股東。
(9)非為本公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。
(10)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
(11)未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。
(12)未有公司法第 30 條各款情事之一。</td><td>0</td></tr>
<tr><td>委員</td><td>謝美姿</td><td>畢業於中原大會計系及上海財經大學工商管理碩士，具有五年以上商務、財務、會計及公司業務所須之工作經驗，目前擔任經典聯合會計師事務所會計師。</td><td>0</td></tr>
<tr><td>委員</td><td>陳夢萍</td><td>畢業於中國文化大學會計系，具有五年以上商務、財務、會計及公司業務所須之工作經驗，目前擔任當代會計師事務所會計師。</td><td>1</td></tr>
</table>

(2) 薪資報酬委員會運作情形資訊

A. 本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。

B. 本屆委員任期：113 年 5 月 10 日至 116 年 4 月 15 日，最近年度(113 年)薪資報酬委員會開會 4 次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際列席次數	實際出(列)席率(%)	備註
召集人	趙培宏	2	100.00	113 年 4 月 16 日卸任
委員	孫德至	2	100.00	113 年 5 月 21 日辭任
召集人	霍玲玲	4	100.00	113 年 5 月 10 日委任
委員	謝美姿	2	100.00	113 年 5 月 10 日委任
委員	陳夢萍	2	100.00	113 年 5 月 10 日委任

其他應記載事項：

一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無此情事。

二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無此情事。

(3) 董事及經理人績效評估及薪酬政策、制度與結構

本公司薪資報酬委員會至少每年開會二次(113 年度開會次數：4 次)，其職能係以善良管理人注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論。

1.訂定並定期檢討董事及經理人績效評估標準與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

2.定期評估董事及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

3.定期檢討薪酬委員會組織規程並提出修正建議。

薪資報酬委員會履行職權時，依循的原則為：

1.確保公司之薪資報酬安排符合相關法令並足以吸引優秀人才。

2.董事及經理人之績效評估及薪資報酬，應參考同業通常水準支給情形，並考量個人所投入之時間、所擔負之職責、達成個人目標情形、擔任其他職位表現、公司近年給予同等職位者之薪資報酬，暨由公司短期及長期業務目標之達成、公司財務狀況等評估個人表現與公司經營績效及未來風險之關聯合理性。

3.不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。

4.針對董事及高階經理人短期績效發放紅利之比例及部分變動薪資報酬支付時間應考量行業特性及公司業務性質予以決定。

5.推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因

推動項目	運作情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專（兼）職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	✓		本公司業經董事會通過訂定「永續發展實務守則」，並依相關規定辦理。	與上市上櫃公司企業社會責任實務守則無重大差異。
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？		✓	本公司雖未設置推動永續發展專（兼）職單位，但對內將透過教育訓練及會議方式向員工說明環境管理系統、提升環保意識；對外則會持續實踐企業社會責任，未來將視需求設置專(兼)職單位。	與上市上櫃公司企業社會責任實務守則無重大差異。
三、環境議題 （一）公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	✓		本公司遵守歐盟RoHS、REACH法規並恪守各項環保規定。	與上市上櫃公司企業社會責任實務守則無重大差異。
（二）公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	✓		本公司之產品則要求減少或限制使用會對環境產生危害的物質，並辦理廢棄物分類及資源回收。	與上市上櫃公司企業社會責任實務守則無重大差異。
（三）公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施？		✓	氣候變遷對本公司現在及未來的潛在風險與機會影響並不顯著，故尚未採取氣候相關議題之評估與因應措施	未來需求則由專責機構評估及擬訂因應措施
（四）公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	✓		本公司致力於實施節能減碳，如照明設備改善、表單文件電子化、節約能源及辦理資源回收利用等措施，讓員工從工作環境深植節能減碳的生活概念，持續減少用電量，以減少碳排放量和生態環境破壞。	與上市上櫃公司企業社會責任實務守則無重大差異。

推動項目	運作情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
四、社會議題 （一）公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？	✓		本公司遵守勞基法等勞動法規，並制定各項管理辦法，保障員工權益。如結社自由、集體協商權、關懷弱勢族群、禁用童工、消除各種形式之強迫勞動、消除雇傭與就業歧視等。	與上市上櫃公司企業社會責任實務守則無重大差異
（二）公司是否訂定及實施合理員工福利措施（包括薪酬、休假及其他福利等），並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？	✓		本公司訂定工作規則及設置福利委員會，明訂各項員工福利措施（包括薪酬、休假及其他福利等），並定期作積效考核將經營績效或成果適當反映於員工薪酬	與上市上櫃公司企業社會責任實務守則無重大差異
（三）公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？	✓		本公司提供良好工作環境，定期實施員工健康檢查並定期或不定期實施安全衛生教育訓練。 113年度本公司員工職災之件數為0件，並未發生員工職災。 113年度本公司火災之件數為0件，並未發生火災事件。	與上市上櫃公司企業社會責任實務守則無重大差異
（四）公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	✓		本公司提供相關內、外部專業教育訓練以有效充實員工職涯技能。	與上市上櫃公司企業社會責任實務守則無重大差異
（五）針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	✓		本公司產品符合ISO9001：2015、 QC080000：2012之規定，產品之行銷及標示，皆遵循相關法規，並與客戶間保持良好之溝通管道，對於客戶所有的回饋皆迅速有效的掌握，且適時調整服務的品質，並與客戶建立良好的互動關係，以達企業永續經營之目標。	與上市上櫃公司企業社會責任實務守則無重大差異

推動項目	運作情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
（六）公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	✓		本公司訂定之「企業社會責任實務守則」中對於供應商商業往來之前，將評估其是否有影響環境與社會之紀錄，並儘量避免與企業之社會責任政策牴觸者進行交易。此外，本公司訂定「供應商HSF管理作業規範」並與合格供應商會簽訂HSF物質保證書，用以要求供應商減少或限制使用會對環境產生危害的物質，並遵守歐盟RoHS、REACH法規。	與上市上櫃公司企業社會責任實務守則無重大差異
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？		✓	本公司正在編製相關企業社會責任報告書及通過相關驗證機構之查證。	編製相關企業社會責任報告書及爭取通過相關驗證機構之查證。

六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：
無重大差異。

七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：
1.推廣並落實環保概念。
2.重視社會關懷，適時幫助及扶持社會弱勢團體。
3.請參閱本公司網站http：//www.force-mos.com/web/index/index.jsp。

上市上櫃公司氣候相關資訊

1 氣候相關資訊執行情形

<table>
<tr><th>項目</th><th>執行情形</th></tr>
<tr><td>1. 敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。
2. 敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務(短期、中期、長期)。
3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。
4. 敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。
5. 若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。
6. 若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。
7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。
8. 若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達</td>
<td>力士科技不僅嚴格遵守各項環境法規，還致力於實施節能減碳，如照明設備改善、表單文件電子化、節約能源及辦理資源回收利用等措施，讓員工從工作環境深植節能減碳的生活概念，持續減少用電量，以減少碳排放量和生態環境破壞。

正面衝擊：為了善盡對環境的責任，我們致力於研發和設計能提高用電效率的 MOSFET。這不僅有助於降低能源消耗，減少碳排放，還能滿足客戶日益增長的需求。透過提供高效能的產品，我們希望能夠在環保和技術創新方面取得雙贏，進一步提升公司的市場競爭力。

負面衝擊：因開發技術較高，若未能成功開發相關的綠能產品，恐造成氣候變遷加劇，且將導致公司經營環境及財務情況惡化。

採取行動：設立永續執行小組，負責永續政策及年度計畫之擬訂，並追蹤與檢視永續發展執行進度。
• 追蹤評核機制：每年依據ISO 14001管理審查程序，針對環境管理進行PDCA之有效性評量。
• 透過永續執行小組，持續追蹤永續政策執行情形及目標達成狀況。
<table>
<tr><td rowspan="2">管理目標</td><td>短期目標（3 年以內）</td><td>中期目標（3-5 年）</td><td>長期目標（5 年以上）</td></tr>
<tr><td>減少產品包裝材料中的塑料和紙張使用量，力求達到〔50%〕的減少幅度。</td><td>減少產品包裝材料中的塑料和紙張使用量，力求達到〔70%〕的減少幅度。</td><td>減少產品包裝材料中的塑料和紙張使用量，力求達到〔90%〕</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量。
9. 溫室氣體盤查及確信情形(另填於下表)。</td>
<td>
<table>
<tr>
<td></td>
<td>無鹵素添加 (HF)減少50%。
溫室氣體排放減量達〔2%〕。</td>
<td>無鹵素添加 (HF)減少〔70%〕。
溫室氣體排放減量達〔3%〕。</td>
<td>的減少幅度。
無鹵素添加 (HF)減少90%。
溫室氣體排放減量達〔4%〕。</td>
</tr>
</table>

封裝廠：我們同步要求封裝廠在代工過程中逐步替換為無鹵材料，這不僅有助於減少有害物質的排放，還能提升產品的環保性能。

年度績效：
• 本公司2024年產品採用無鹵(HF)的比例為[50%]。
• 2024年已完成ISO 14064 溫室氣體盤查，並將持續遵循相關法規要求。
</td>
</tr>
</table>

1-1 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

1-1-1 溫室氣體盤查資訊：

單位：公噸 CO2e

	2023
範疇一	34.1303
範疇二	57.8588
排放量（範疇一+二合計）	91.9891

註：力士因應溫室氣體減量與管控，自2023年開始進行組織溫室氣體第一次盤查，並經第三方驗證機構查證，故將溫室氣體盤查基準年定為 2023 年。

1-1-2 溫室氣體確信資訊：

格瑞國際驗證有限公司
GREAT International Certification Co., Ltd.

Statement No.: Great-GHGER-24-1103

Greenhouse Gas Emission and Removal Verification Statement

FORCE MOS TECHNOLOGY CO., LTD.

Greenhouse gas emission and removal verification is conducted at the following location:

24 F., No. 555, Siyuan Rd., Xinzhuang Dist., New Taipei City, Taiwan (R.O.C.)

Verification on November 22 and 29, 2024 in accordance with ISO 14064-3:2019 and qualification granted:

ISO 14064-1:2018

Greenhouse gas emission information:

Direct emissions (Category 1): 34.1303metric tonnes of CO_2 equivalent (CO_2-e);

Indirect emissions (Category 2): 57.8588metric tonnes of CO_2 equivalent (CO_2-e);

Other selected indirect emission categories (Categories 3-6) are listed on the table in the following pages.

- Verification goal: GREAT collects and verifies the information disclosed in support of greenhouse gas claims fairly and objectively from an independent third-party standpoint, ensuring that the reported information meets the standards of accuracy, completeness, consistency and transparency, and that the content is free of errors or omissions place.
- Reporting period: January 1, 2023 to December 31, 2023.
- Categories 1 and 2 are verified at reasonable assurance level.
- Categories 3 to 6 are verified at limited assurance level.
- Uncertainty assessment 95% confidence level: -7.07% to +7.07%. (Materiality threshold: 5%)

W. J. Chen, Managing Director

Initial Issuance Date: DEC. 11th, 2024 Latest Issuance Date: DEC. 11th, 2024

- Types of greenhouse gases reported include CO_2, CH_4, N_2O and HFCs.
- Emission factors: Power emission factor in 2023 is 0.494 $kgCO_2e/kWh$; other emission factors refer to EPA management table 6.0.4. GWP values of various greenhouse gases are based on the 6th assessment report of IPCC.

Page 1 of 3

This verification statement is invalid without the full scopes, categories, criteria, level of assurance and findings available on the Statement.
Verification Body: Great International Certification Co., Ltd. Address: 4F., No. 28, Dahua 1st St., Dayuan Dist., Taoyuan City 337002, Taiwan (R.O.C.)

- This statement above is based on the conclusion drawn from the verification of the relevant information provided by the client being verified. Therefore, GREAT thought the verified information are complete and valid.
- Any questions or concerns related to the content of this statement or relevant issues shall be addressed by the client being verified (customer category code: A-11).
- The organization reported the following data on greenhouse gas emissions and removals between January 1, 2023 and December 31, 2023:

Unit: metric tonnes CO_2-e

Reporting boundary category		Notes	Greenhouse gas emission
Category 1: Direct greenhouse gas emissions and removals			34.1303
1.1	Direct emissions from stationary combustion	Dynamotor	0
1.2	Direct emissions from mobile combustion	Gasoline Car, Diesel car	33.9936
1.3	Direct process emissions and removals from industrial processes		NS*
1.4	Direct and temporary release of greenhouse gases by human activities	Refrigeration equipment, Water dispenser, Air conditioning equipment, etc. ...	0.1367
1.5	Direct emissions and removals from land use, land use change and forestry		NS*
Category 2: Indirect greenhouse gas emissions generation from imported energy			57.8588
2.1	Indirect emissions from imported electricity	Outsourced electricity.	57.8588
2.2	Indirect emissions from imported energy		NS*
Category 3: Indirect greenhouse gas emissions from transportation			NS*
3.1	Emissions from upstream transport and distribution of goods		NS*
3.2	Emissions from downstream transport and distribution of goods		NS*
3.3	Emissions from employee commuting		NS*
3.4	Emissions from client and visitor transportation vehicle		NS*
3.5	Emissions from business travels		NS*
Category 4: Indirect greenhouse gas emissions from products used by the organization			NS*
4.1	Indirect greenhouse gas emissions from goods purchased by the organization		NS*
4.2	Indirect greenhouse gas emissions from capital goods		NS*
4.3	Indirect greenhouse gas emissions from the disposal of solid and liquid wastes		NS*
4.4	Indirect greenhouse gas emissions from the use of assets		NS*
4.5	Indirect greenhouse gas emissions from the use of services that are not described in the above subcategories		NS*
Category 5: Indirect greenhouse gas emissions associated with the use of products from the organization			NS*
5.1	Emissions or removals from the use stage of the products		NS*
5.2	Emissions from downstream leased assets		NS*
5.3	Emission from end-of-life stage of the products		NS*
5.4	Emission from investment		NS*

This verification statement is invalid without the full scopes, categories, criteria, level of assurance and findings available on the Statement.
Verification Body: Great International Certification Co., Ltd. Address: 4F., No. 28, Dahua 1st St., Dayuan Dist., Taoyuan City 337002, Taiwan (R.O.C.)

Category 6: Indirect greenhouse gas emissions from other sources		NS*
Direct removals		NS*
Annual total storage volume		NS*
Carbon financial instrument		NS*

*: excluded from the calculation for the above

Coverage of the reporting boundary subcategories in the verification activities for the organization:

Client or organization name	Address	Subcategory
FORCE MOS TECHNOLOGY CO., LTD. 力士科技股份有限公司	24 F., No. 555, Siyuan Rd., Xinzhuang Dist., New Taipei City, Taiwan (R.O.C.) 新北市新莊區思源路 555 號 24 樓	1.2,1.4, 2.1

This verification statement is invalid without the full scopes, categories, criteria, level of assurance and findings available on the Statement.
Verification Body: Great International Certification Co., Ltd. Address: 4F., No. 28, Dahua 1st St., Dayuan Dist., Taoyuan City 337002, Taiwan (R.O.C.)

1-2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫：規劃中。

本公司基本資料	依上市櫃公司永續發展路徑圖規定至少應揭露
□ 資本額 100 億元以上公司、鋼鐵業、水泥業 □ 資本額 50 億元以上未達 100 億元之公司 ■ 資本額未達 50 億元之公司	□ 母公司個體盤查 □ 合併財務報告子公司盤查 □ 母公司個體確信 □ 合併財務報告子公司確信

範疇一	總排放量 (公噸 CO2e)	密集度 (公噸 CO2e/千元)	確信機構	確信情形說明
母公司	34.1303	盤查中	格瑞國際驗證有限公司	如 1-1-2 附圖
子公司	盤查中	盤查中		
合計	盤查中	盤查中		

6.履行誠信經營情形

評估項目	是	否	運作情形摘要說明	與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
一、訂定誠信經營政策及方案 （一）公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？	V		(一)本公司為建立誠信經營之企業文化及使企業健全永續發展，依法令訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」，「道德行為準則」其制定及修定皆經董事會決議通過後，提交股東會報告，並於本公司網站揭露，明定本公司、子公司之董事、經理人、受僱人、受任人或具有實質控制能力者應確實遵循。	(一)符合

評估項目	是	否	運作情形摘要說明	與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
（二）公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？	V		(二)本公司針對具較高不誠信行為風險之營業活動，建立及推行防範措施如下： 1. 人員於執行業務時不得行賄及收賄；不得藉職務上之關係要求廠商招待、饋贈、或接受佣金、酬金及其他不正當利益…等，並要求人員承諾以誠信廉潔執行職務，簽署「誠信廉潔承諾書」。 2. 對提供政治獻金、慈善捐贈或贊助，依「核決權限管理程序」及符合營運所在地法令之規定辦理。 3. 人員於執行業務時，需遵守智慧財產相關法規、公司內部作業程序及契約規定，不得有侵害智慧財產權之行為。 4. 於公司網站設置利害關係人專區，以防止損害利害關係人之權益。 5. 於內部規章、年報、公司網站或公開說明書揭露誠信經營政策，並適時於法人說明會等對外活動上宣示。 6. 與他人建立商業關係前，先行評估代理商、供應商、客戶或其他商業往來對象之合法性、誠信經營政策，以及是否曾涉有不誠信行為之紀錄。 7. 鼓勵內部及外部人員檢舉不誠信行為或不當行為，於公司網站建立並公告檢舉/申訴信箱、專線，供本公司內部及外部人員使用。 8. 定期舉辦訓練及宣導，向本公司人員及利害關係人傳達誠信之重要性。	(二)符合
（三）公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，	V		(三)本公司於「誠信經營守則」、「道德行為準則」及員工「人事規章」等明定禁止行賄、收賄、舞弊圖利、提供或接受不正當利益、侵害營業秘密、商標權、專利權、著作權及其他	(三)符合

評估項目	是	否	運作情形摘要說明	與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？			智慧財產權、內線交易、損害利害關係人之權益等不誠信行為，並明訂違反誠信經營規定之懲戒與申訴制度，若確有違反誠信經營規定者，視情節輕重提報懲處，並於內部網頁揭露相關內容及處理結果。	
二、落實誠信經營 （一）公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？	V		(一)本公司於對外各項商業契約中，已明訂關於誠信行為之規範條款，明確表達本公司立場。	(一)符合
（二）公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？	V		(二)以永續發展委員會為本公司推動誠信經營之兼職專責單位，負責誠信經營政策與防範方案之制定、監督執行與查核，並定期於次年度第 1 季前董事會報告其執行情形。已於 113 年 12 月 27 日向董事會報告 113 年度舉辦誠信經營之教育訓練、宣導及承諾相關事宜，及其遵循及辦理情形。	(二)符合
（三）公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？	V		(三)本公司已依法令制訂董事會議事規範，處理董事之利益衝突事項。董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。	(三)符合
（四）公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制	V		(四)本公司為合理確保營運之效果及效率、財務報導之可靠、及時、透明及相關法令規章遵循等目標之達成，建立有效的會	(四)符合

評估項目	是	否	運作情形摘要說明	與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？			計制度、內部控制制度為事務運作參考準則，制度並設計自我監督之機制，缺失一經辨認，相關部門即採取更正行動。稽核室將前述事項納入查核，並定期向董事會報告缺失改善情形，以確保公司日常運作符合誠信經營原則。	
（五）公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	V		(五)公司已定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練。113 年度內部舉辦或參加外部機構與誠信經營相關之教育訓練及測驗，課程主題包括「誠信、道德、永續發展、社會責任、公司治理、風險管理、內部控制、稽核及審計、會計制度、人事規章、法規遵循及防範內線交易」等，計 24 人次，合計 111 小時	(五)符合
三、公司檢舉制度之運作情形 （一）公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？	V		(一)本公司人員若發現有違反誠信經營之情事，需立即向內部稽核主管進行檢舉。 本公司將誠信經營與員工績效考核及人力資源政策結合，對於本公司人員違反誠信行為情節重大者，依相關法令或依公司人事規章予以懲處。本公司於公司網站建立並公告檢舉信箱、專線，供本公司內部及外部人員使用。	(一)符合
（二）公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？ （三）公司是否採取保護檢舉人不因	V		(二)、(三)本公司人員發現有違反誠信經營守則之情事時，需主動向內部稽核主管舉報，本公司對於檢舉人及檢舉內容確實保密，並依「誠信經營作業程序及行為指南」之調查標準程序處理，同時承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。	(二)符合 (三)符合

評估項目	是	否	運作情形摘要說明	與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
檢舉而遭受不當處置之措施？				
四、加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？	V		(一)本公司於年報「落實誠信經營情形」專章、公開資訊觀測站及網站之「公司治理」、「永續發展」網頁中，揭露「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、誠信經營理念及推動成效..等。本公司指定專人負責公司資訊之蒐集	符合
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：	V		本公司現階段針對誠信經營守則之規範與管理措施配套會進行定期盤點與維護，確保相關做法足以涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」所規範的範圍，並不違反該守則之精神。	符合
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：（如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形）	V		本公司秉持最高治理標準，積極推動營運透明化，以維護利害關係人（股東、客戶、供應商、員工、政府、非營利組織、社區、媒體）權益為原則。其中針對合作夥伴與關係企業的部份，本公司已建立關於誠信經營之常態宣導，共同維護企業商譽，追求永續經營。	符合

7.其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊：本公司自 113 年起，定期於每年第四季將落實誠信經營執行情形提報董事會報告，最近一次報告日期為 113 年 12 月 27 日第八屆第五次董事會。

8.內部控制制度執行狀況：

(1)內部控制聲明書：請參閱第 46 頁。

(2)委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。

力士科技股份有限公司

內部控制制度聲明書

日期：114年2月24日

本公司民國113年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率（含獲利、績效及保障資產安全等）、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。

二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。

三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」（以下簡稱「處理準則」）規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境，2.風險評估，3.控制作業，4.資訊與溝通，及5.監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。

四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。

五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國113年12月31日的內部控制制度（含對子公司之監督與管理），包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。

六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。
上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。

七、本聲明書業經本公司民國114年2月24日董事會通過，出席董事八人中，有0人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。

力士科技股份有限公司

董事長兼總經理　鍾明道

9.最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議：

日 期	類 別	重要決議事項
113.01.17	董事會	(1) 通過本公司「董事會績效評估」案。 (2) 通過評估及檢討一一二年度董事及經理人績效與薪資報酬之制度及標準案。 (3) 通過全面改選董事九席(含獨立董事四席)案。 (4) 通過提名第八屆董事(含獨立董事)候選人名單案。 (5) 通過一一三年股東常會受理股東提案之期間及處所案。 (6) 通過民國一一三年股東常會召開事宜案。
113.03.01	董事會	(1) 通過本公司出具民國一一二年度「內部控制制度聲明書」案。 (2) 通過民國一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。 (3) 通過民國一一二年度營業報告書及財務報表案。 (4) 通過民國一一二年度盈餘分配案。 (5) 通過資本公積發放現金股利案。 (6) 通過**受理股東提案暨**本公司第八屆董事(含獨立董事)候選人提名審查結果案。 (7) 通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 (8) 通過評估簽證會計師獨立性及適任性案。
113.04.16	股東常會	(1) 承認民國一一二年度營業報告書及財務報表案。 (2) 承認民國一一二年度盈餘分配案。 (3) 全面改選董事九席(含獨立董事四席)案。 (4) 通過解除董事競業禁止之限制案。
113.04.16	董事會	(1) 選舉董事長案。
113.05.10	董事會	(1) 承認一一三年第一季合併財務報告案。 (2) 委任本公司第六屆薪資報酬委員會委員案。
113.08.06	董事會	(1) 承認本公司一一三年第二季合併財務報告案。 (2) 通過買回本公司已發行股份轉讓予員工案。
113.11.05	董事會	(1) 承認本公司一一三年第三季合併財務報告案。
113.12.27	董事會	(1) 通過本公司一一四年度稽核計畫案。

10.最近年度及截至年報刊印日止董事或獨立董事對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者：無。

四、會計師公費資訊：

金額單位：新臺幣千元

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費	合計	備註
安侯建業聯合會計師事務所	寇惠植	113.1.1~113.12.31	2,850	610	3,460	非審計公費為稅務簽證等
	李慈慧					

五、更換會計師資訊：無。

六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間：無。

七、最近年度及截至年報刊印日止董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形：

1.董事、經理人及大股東股權變動情形：

單位：股

職稱	姓名	113 年度		114 年截至 3 月 31 日	
		持有股數增(減)數	質押股數增(減)數	持有股數增(減)數	質押股數增(減)數
董事/董事長兼總經理	鍾明道	50,000	–	_	–
董事	張晉誠	–	–	_	–
董事	林才熙	–	–	_	–
董事	廖裕輝	–	–	_	–
董事/技術長	涂高維	–	–	_	–
法人董事	秉家投資有限公司	–	–	_	–
	代表人：鍾秉家	–	–	_	–
獨立董事	趙培宏	–	–	_	–
獨立董事	孫德至	–	–	_	–
獨立董事	霍玲玲	_	_	_	
獨立董事	謝美姿	–	–	_	–
獨立董事	陳夢萍	–	–	_	–
副總經理	鍾秉家	–	–	_	–
研發處長	張淵舜	_	_	_	-
營運處資深處長	曾振益	_	_	_	_
品保處處長	呂宏松	1,000	_	_	–
財會經理	林祐年	–	–	_	–

2.股權移轉之相對人為關係人者：無。

3.股權質押之相對人為關係人者：無。

八、持股比例占前十大股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係資訊

持股比例占前十大股東間互為關係人資料

114 年 3 月 22 日；單位：股

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係		備註
	股數	持股比率(%)	股數	持股比率(%)	股數	持股比率(%)	名稱	關係	
鍾明道	2,526,550	7.45	222,000	0.66	-	-	秉家投資有限公司 鍾秉家 林宣妤 林于傑	該公司負責人 父子 夫妻 妻舅	
秉家投資有限公司代表人：鍾明道	1,837,200	5.42	–	–	–	–	鍾秉家 林宣妤 林于傑	父子 夫妻 妻舅	
	2,526,550	7.45	222,000	0.66	–	–			
力士科技股份有限公司	1,150,000	3.39	–	–	–	–	–	–	
宜鼎投資股份有限公司代表人：林于傑	1,060,000	3.13	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	鍾明道 鍾秉家 林宣妤	姐夫 甥舅 姊弟	
鍾秉家	1,050,990	3.10	–	–		-	秉家投資有限公司 鍾明道 林宣妤 林于傑	法人董事代表人 父子 母子 甥舅	
井豐投資股份有限公司代表人：楊淑美	885,600	2.61	–	–	–	–	–	–	
	34,000	0.10	–	–	–	–	–	–	
禾鼎科技股份有限公司代表人：高堂祐	680,000	2.01	–	–	–	–	–	–	
廖裕輝	660,000	1.95	–	–	–	–	–	–	
馨鼎企業股份有限公司代表人：林宣妤	565,000	1.67	–	–	–	–	–	–	
	222,000	0.66	2,526,550	7.45	–	–	鍾明道 鍾秉家 林于傑	夫妻 母子 姊弟	
宜素投資有限公司代表人：鍾明道	455,000	1.34	–	–	–	–	–	–	
	2,526,550	7.45	222,000	0.66	–	–	鍾秉家 林宣妤 林于傑	父子 夫妻 妻舅	

九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例：

綜合持股比例

單位：股；%

轉投資事業（註）	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
力仕半導體(深圳)有限公司	-	100%	-	-	-	100%

註：係公司採用權益法之投資。

參、募資情形

一、資本及股份

(一)股本來源

114 年 3 月 22 日；單位：股

股份種類	核　定　股　本			備　註
	流通在外股份	未發行股份	合　計	
普通股	33,890,800	26,109,200	60,000,000	上市(櫃)股票

114 年 3 月 22 日；單位：仟股/仟元

年月	發行價格(元)	核定股本		實收股本		備　　註		
		股　數	金　額	股　數	金　額	股本來源	以現金以外之財產抵充股款者	其他
96.06	10	1,000	10,000	1,000	10,000	發起設立	無	註 1
96.09	10	4,300	43,000	4,300	43,000	現金增資 33,000 仟元	無	註 2
97.02	10	30,000	300,000	10,000	100,000	現金增資 57,000 仟元	無	註 3
97.10	10	30,000	300,000	15,000	150,000	現金增資 50,000 仟元	無	註 4
99.06	10	30,000	300,000	20,000	200,000	現金增資 50,000 仟元	無	註 5
107.11	10	30,000	300,000	25,000	250,000	現金增資 50,000 千元	無	註 6
111.03	10	30,000	300,000	28,334	283,340	現金增資 33,340 千元	無	註 7
112.06	10	60,000	600,000	33,891	338,908	盈餘轉增資 55,568 千元	無	註 8

註1： 96年06月11日　經授中字第09632252810號函核准
註2： 96年09月14日　經授中字第09632766250號函核准
註3： 97年02月20日　經授中字第09731747630號函核准
註4： 97年10月15日　高市府建二公字第09700707380號函核准
註5： 99年06月08日　北府經登字第0993090780號函核准
註6： 107年11月23日　新北府經司字第1078075220號函核准
註7： 111年03月28日　新北府經司字第1118020672號函核准
註8： 112年06月27日　新北府經司字第1128041775號函核准

總括申報制度相關資訊：不適用

(二) 主要股東名單

114 年 3 月 22 日；單位：股；%

股份 主要股東名稱	持有股數(股)	持股比例(%)
鍾明道	2,526,550	7.45%
秉家投資有限公司	1,837,200	5.42%
力士科技股份有限公司	1,150,000	3.39%
宜鼎投資股份有限公司	1,060,000	3.13%
鍾秉家	1,050,990	3.10%
井豐投資股份有限公司	885,600	2.61%
禾鼎科技股份有限公司	680,000	2.01%
廖裕輝	660,000	1.95%
馨鼎企業股份有限公司	565,000	1.67%
宜素投資有限公司	455,000	1.34%
合計	10,870,340	32.07%

(三)公司股利政策及執行情形

1.公司章程所訂之股利政策：

本公司每年決算如有盈餘，除依法提繳稅款外，應先彌補以往虧損，次就其餘額提列百分之十為法定盈餘公積；但法定盈餘公積累積已達本公司實收資本額時，不在此限。另依公司營運需要及法令規定提列特別盈餘公積。如尚有盈餘併同期初未分配盈餘，由董事會擬具分派議案，提請股東會決議分派之。

本公司股東紅利分派得以現金或股票方式發放，其數額以不低於當年度稅後盈餘百分之十，且股東現金紅利分派之比例不低於股東紅利總額之百分之十。本公司正值企業成長階段，考量所處環境及產業成長特性，並因應未來資金需求及長期財務規劃，股利之分派係採用剩餘股利政策，主要係依據本公司未來之資本預算規劃來衡量未來年度之資金需求，然後先以保留盈餘融通所需之資金後，剩餘之盈餘才以現金股利及股票股利之方式分派。

2.本年度擬議股利分派之情形：

本公司民國一一三年度稅後淨損 77,070 千元，故不分配股東股息，經 114 年 2 月 24 日董事會決議通過，並列入 114 年 5 月 20 日股東常會承認事項。

(四)本年度擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：不適用。

(五)員工酬勞及董事酬勞：

1.公司章程所載員工、董事及監察人酬勞之成數或範圍：

本公司年度如有獲利，公司應以當年度扣除員工、董事酬勞前之稅前利益百分之一至百分之十五分派員工酬勞，及以不高於百分之三分派董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應先彌補累積虧損後，再就餘額依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。前項員工酬勞發給股票或現金之對象，包括符合一定條件之從屬公司員工。

2.本期估列員工、董事酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理：無此情事。

3.董事會通過分派酬勞情形：

(1)以現金或股票分派之員工酬勞及董事、監察人酬勞金額：

本公司 114 年 2 月 24 日董事會通過之員工酬勞分配案並無配發員工酬勞及董事、監察人酬勞之情形，故不適用。

(2)以股票分派之員工酬勞金額占本期稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：

本公司 114 年 2 月 24 日董事會通過之員工酬勞分配案並無配發員工股票紅利之情形，故不適用。

4.前一年度員工、董事酬勞之實際分派情形（包括分派股數、金額及股價）、其與認列員工、董事及監察人酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：無差異。

(六)公司買回本公司股份情形：

買回期次	第二次
買回目的	轉讓員工
買回期間	113/8/7~113/10/6
買回區間價格	28.0~66.9(註 1)
已買回股份種類及數量	普通股 600,000 股
已買回股份金額	23,575,576 元
已買回數量佔預定買回數量之比率(%)	1.77%
已辦理銷除及轉讓之股份數量	0
累積持有本公司股份數量	1,150,000 股
累積持有本公司股份數量佔已發行股份總數比率(%)	3.39%

註 1：若股價低於所定買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份。

二、公司債(含海外公司債)辦理情形：無。

三、特別股辦理情形：無。

四、海外存託憑證之辦理情形：無。

五、員工認股權憑證辦理情形：無。

六、限制員工權利新股辦理情形：無。

七、併購或受讓他公司股份發行新股尚在進行中辦理情形：無。

八、資金運用計畫執行情形：

截至年報刊印日之前一季止,前各次發行或私募有價證券尚未完成或最近三年內已完成且計劃效益尚未顯現者之分析：無此情形。

肆、營運概況

一、業務內容

(一)業務範圍

(1)公司所營業務之主要內容

A.I501010 產品設計業。

B.F119010 電子材料批發業。

C.F401010 國際貿易業。

D.I301010 資訊軟體服務業。

E.ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

(2)營業比重

單位：新臺幣仟元；%

年度 產品類別	112 年度		113 年度	
	金額	營業比重	金額	營業比重
MOSFET	372,891	50.49%	512,780	62.91%
Wafer	288,900	39.12%	217,232	26.65%
Diode	15,872	2.15%	12,484	1.53%
Transistor	14,329	1.94%	10,670	1.31%
ESD	45,197	6.12%	61,908	7.60%
積體電路設計	1,330	0.18%	0	0.00%
合計	738,519	100.00%	815,074	100.00%

(3)目前之商品(服務)項目

A. TrenchMosfet：低、中壓 MOSFET。

B. Wafer：尚未封裝為 MOSFET 之半成品晶圓片。

C. Transistor：雙極性接面型電晶體(BJT)。

D. Diode：具靜電防護能力等二極體產品。

E. 其他：網路變壓器等產品。

(4)計劃開發之新產品(服務)

計畫開發之新產品			應用領域
項目	產品類別	轉換電阻 (歐姆)	
1.	60V N Channel power MOSFET embeded ESD	2.0mΩ~20mΩ	電動工具、電動腳踏車、電動車、充電樁、不斷電系統
2.	150V N Channel power MOSFET	18mΩ~200mΩ	電動車、充電樁、不斷電系統
3.	200V N Channel power MOSFET	50mΩ~400mΩ	電動車、不斷電系統
4.	60V N Channel Split Gate power MOSFET embedded ESD	4.5mΩ~33mΩ	電動工具、電動腳踏車、電動車、充電樁、不斷電系統

計畫開發之新產品			應用領域
項目	產品類別	轉換電阻 (歐姆)	
5.	150V N Channel Split Gate power MOSFET	10mΩ~35mΩ	電動車、充電樁、不斷電系統
6.	30V RTG+ESD MOSFET	2mΩ~6mΩ	電池保護及充放電控制
7.	40V RTG MOSFET	1.2mΩ~10mΩ	電動工具、電動腳踏車、電動車、充電樁、不斷電系統
8.	12V MOSFET Array	100mΩ~120mΩ	Mini-LED 背光電源控制
9.	650V GaN	100mΩ~350mΩ	電源轉換供應器、伺服器電源管理、電動車
10.	800V GaN	100mΩ~350mΩ	電源轉換供應器、伺服器電源管理、電動車

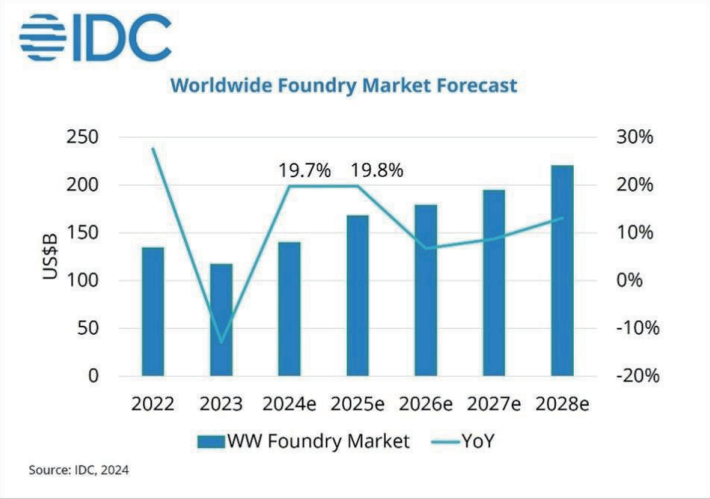
(二)產業概況

(1)產業之現況與發展

A.半導體市場概況

半導體是一種導電性可受控制，常溫下導電性能介於導體與絕緣體之間的材料，經人為摻入特定雜質元素後，即可對導電性進行調整及控制；半導體為電子元件產業之核心技術，並廣泛應用於各式電子產品中。

圖一、全球半導體產業市場規模



資料來源：IDC 國際數據資訊有限公司

全球半導體市場近二十年來發展迅速，已形成龐大的產業鏈，根據世界半導體貿易統計組織(WSTS)統計，半導體市場除在 2009 年、及 2019 年有明顯之負成長外，就長期趨勢而言，仍呈現穩定成長(圖一)。自 2013 年開始，由於終端市場之需求多元成長，網路終端應用、雲端運算、智能電子產品、手持行動裝置以及工業應用領域等市場需求拉升的強力推動下，加速產業鏈建置與升級，並帶動半導體產業榮景。2019 年各式消費性電子產品市場

逐漸飽和，且主要廠牌智慧型手機缺乏創新功能無法刺激換機，又因 5G 網路建置尚未完成使物聯網科技尚無法普及，導致終端需求放緩影響半導體出貨量下滑；且 2019 年下半年受中美貿易戰影響明顯，美國對中國半導體產業廠商祭出多道封殺令，除提高美國半導體零組件出口規範嚴謹程度，並限制出貨予特定廠家，使半導體供應鏈受影響，且對於供給端及需求端皆為重大打擊。面對貿易戰走勢未明且客戶下單趨向保守，半導體市場規模成長明顯趨緩，市場銷售額亦較 2018 年下滑約 12%(表一)。2020 年雖全球因新冠肺炎疫情肆虐影響，全球各地廠商受政府規範間歇性停工，惟因異地備援及在家上班等替代方案醞釀遠距商機，且主要經濟體加速 5G 基礎建設進度，連帶推升雲端應用、高速運算、人工智慧及物聯網等新興科技領域需求，又受惠於 2020 年下半年疫情趨緩後之報復性消費，使半導體市場銷售額逆勢較去年小幅成長約 5.1%。

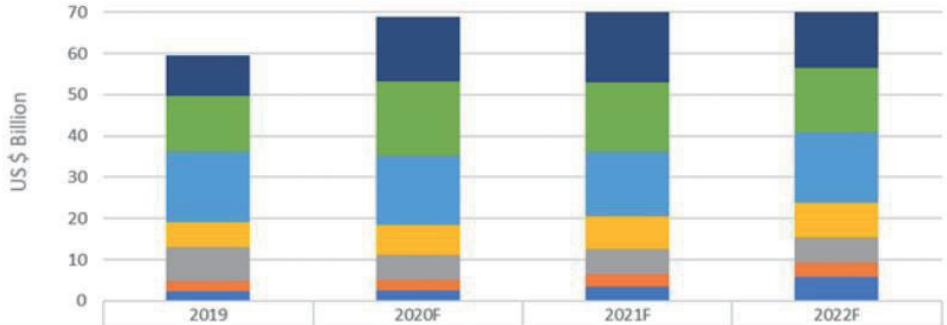
表一、全球半導體產業市場規模預測

Fall 2020	Amounts in US$M			Year on Year Growth in %		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Americas	78,619	**93,343**	**102,164**	-23.7	18.7	9.5
Europe	39,816	**36,452**	**38,543**	-7.3	-8.4	5.7
Japan	35,993	**35,759**	**37,841**	-9.9	-0.6	5.8
Asia Pacific	257,879	**267,590**	**290,854**	-8.8	3.8	8.7
Total World - $M	412,307	**433,145**	**469,403**	-12.0	5.1	8.4
Discrete Semiconductors	23,881	**23,593**	**25,292**	-0.9	-1.2	7.2
Optoelectronics	41,561	**40,481**	**44,628**	9.3	-2.6	10.2
Sensors	13,511	**14,515**	**15,642**	1.2	7.4	7.8
Integrated Circuits	333,354	**354,556**	**383,840**	-15.2	6.4	8.3
Analog	53,939	53,954	58,578	-8.2	0.0	8.6
Micro	66,440	67,744	68,444	-1.2	2.0	1.0
Logic	106,535	113,419	121,507	-2.5	6.5	7.1
Memory	106,440	119,440	135,311	-32.6	12.2	13.3
Total Products - $M	412,307	**433,145**	**469,403**	-12.0	5.1	8.4

Note: Numbers in the table are rounded to whole millions of dollars, which may cause totals by region and totals by product group to differ slightly.

雖然半導體市場瞬息萬變且難以預測，不過市場普遍靠看好 5G 網路建置、物聯網、人工智慧及自動化、工業 4.0、車用電子等新興產業持續發展，並強調產業升級與轉型。根據 WSTS 出具之產業報告預測，半導體產業規模 2021 年將維持成長，並以光電及記憶體區塊為主；以區域別檢視市場成長情形，美國、亞太地區因為半導體主要發展區域，故成長將較明顯，分別約為 9.5%及 8.7%，在中、美、韓等國家為鞏固半導體產業地位，紛紛祭出半導體投產及研發計畫，WSTS 預估 2021 年全球半導體市場銷售額年成長率將約為 8.4%(表一)。

圖二、全球半導體地區別研發設備銷售額



	2019	2020F	2021F	2022F
Korea	9.9	15.7	18.9	19.7
China	13.4	18.1	16.8	15.6
Taiwan	17.1	16.8	15.6	17.2
Japan	6.2	7.3	7.9	8.4
North America	8.1	6.1	6.1	6.0
SEA/ROW	2.5	2.6	3.0	3.4
Europe	2.3	2.4	3.5	5.9

資料來源：國際半導體產業協會(SEMI), 2020

從半導體製造新設備銷售金額來看 2019~2022 年半導體發展，根據國際半導體產業協會(SEMI)出具之報告統計，2020 年半導體製造新設備銷售金額較 2019 年成長 16%，達約 690 億美元(圖二)。SEMI 同時預估，在記憶體市場成長動能充足、先進邏輯製程和晶圓代工廠持續投資滿足尖端科技發展以及後段封測需求，並看好未來 5G、電腦高效能運算等運用需求強勁，將帶動半導體業成長，也促使半導體設備步入超級循環週期，2021 年及 2022 年半導體設備市場銷售金額將分別達 718 億美元及 762 億美元。其中，韓國、中國及台灣為半導體設備市場銷售前三名，且預估 2021 年及 2022 年韓國及日本設備銷售將呈現連續正增長，而台灣因於過去半導體業者已持續大幅度挹注資金動能投資軟硬體設備，故 2021 年及 2022 年與其他市場相較雖仍有相當之設備支出，惟成長動能將有所趨緩。

表二、全球半導體產業區域市場發展結構

單位：億美元

項目 / 地區	2018 年		2019 年		2020 年		2021 年(F)	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
美洲	1,030	21.97	786	19.06	933	21.54	1,022	21.77
歐洲	429	9.15	398	9.65	364	8.40	385	8.20
日本	400	8.53	360	8.73	358	8.27	378	8.05
亞太地區	2,829	60.35	2,579	62.56	2,676	61.79	2,909	61.98
合計	4,688	100.00	4,123	100.00	4,331	100.00	4,694	100.00

資料來源：世界半導體貿易統計組織(WSTS), 2020

惟以半導體發展區域之銷售佔比檢視，WSTS 預估 2021 年美洲、歐洲、日本及亞太地區市場占比與 2020 年相差不大，仍以亞太地區為主要消費

市場(表二)。隨近年半導體產業技術移轉及產業板塊輪動，主要核心市場已由北美及歐洲等傳統半導體強權逐漸向亞太地區轉移，惟檢視目前預估之 2021 年銷售情形，短期內此一轉移現象已達一定規模，大幅變動機率尚屬有限。

檢視台灣半導體產業鏈發展情形，由於台灣 IC 產業上下游產業鍊完整，專業分工模式獨步全球，使台灣的半導體產業發展蓬勃，近二十年的發展情形貼近全球成長趨勢，整體而言為穩定成長。根據台灣半導體產業協會(TSIA)及工研院(IEK)產業科技國際策略發展統計，台灣半導體產業 2020 年產值首度突破新台幣 3 兆元關卡，約達 3.22 兆，較去年成長達 20.9%，其中 IC 設計產業約達 8,529 億，較去年成長 23.1%(表三)，成長顯著。台灣於新冠肺炎肆虐全球之疫情期間，因政府及社會控制疫情得當，使本土產業未受明顯影響，且受惠疫情加速世界各地產業轉型，更醞釀在家上班及線上教學、購物之遠距商機，伴隨宅經濟一起帶動台灣傳統筆記型電腦與網通產業等代工需求成長強勁，在全球政府祭出財政刺激措施與各式產業基建布局，也帶動台灣半導體產業從 IC 設計、晶圓代工到封裝測試的持續成長。

表三、2021 年台灣 IC 產業鏈產值統計

單位：新台幣億元

億新臺幣	2017	2017 成長率	2018	2018 成長率	2019	2019 成長率	2020	2020 成長率	2021 (e)	2021 (e) 成長率
IC 產業產值	24,623	0.5%	26,199	6.4%	26,656	1.7%	32,222	20.9%	34,981	8.6%
IC 設計業	6,171	-5.5%	6,413	3.9%	6,928	8.0%	8,529	23.1%	9,459	10.9%
IC 製造業	13,682	2.7%	14,856	8.6%	14,721	-0.9%	18,203	23.7%	19,657	8.0%
晶圓代工	12,061	5.0%	12,851	5.0%	13,125	2.1%	16,297	24.2%	17,675	8.5%
記憶體與其他製造	1,621	-11.8%	2,005	23.7%	1,596	-20.4%	1,906	19.4%	1,982	4.0%
IC 封裝業	3,330	2.8%	3,445	3.5%	3,463	0.5%	3,775	9.0%	4,025	6.6%
IC 測試業	1,440	2.9%	1,485	3.1%	1,544	4.0%	1,715	11.1%	1,840	7.3%
IC 產品產值	7,792	-6.9%	8,418	8.0%	8,524	1.3%	10,435	22.4%	11,441	9.6%
全球半導體市場(億美元)及成長率(%)	4,122	21.6%	4,688	13.7%	4,123	-12.0%	4,404	6.8%	4,883	10.9%

資料來源：台灣半導體產業協會(TSIA)、工研院 IEK, 2021

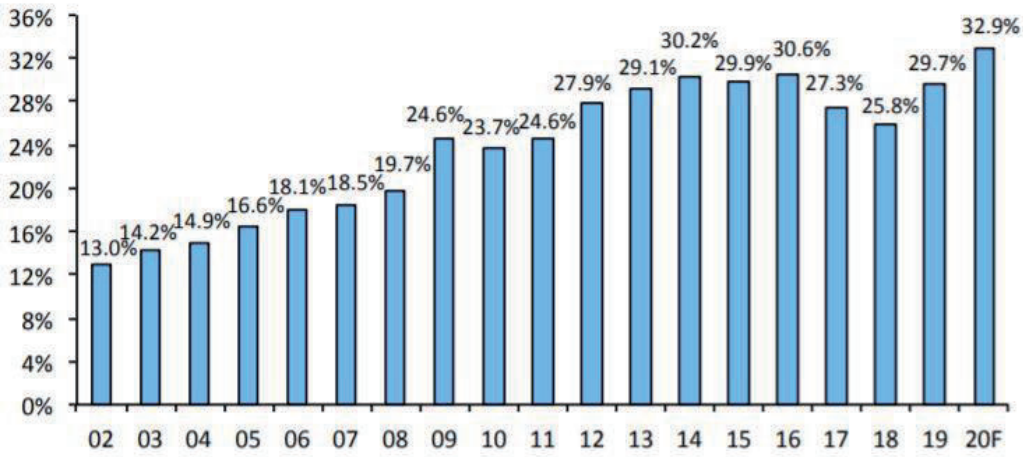
半導體產業以產業鏈來看，可分為上游之 IC 設計、中游之 IC 製造與下游之 IC 封裝測試等。近年來智慧型手機與終端電子產品功能推陳出新，又因 5G 網路、物聯網及 AI 人工智慧等新興技術取得突破性進展，於不久之將來將大幅改變未來世界樣貌，使整體半導體產業依舊具有可觀之成長潛力。

台灣半導體產業鏈完整、分工專業，且政府積極培植使產業規模迅速成長茁壯；除上下游產業具有群聚優勢外，還可就近取得晶圓代工廠及封裝測試廠產能等外部資源；此外，台灣地處優勢位置，緊鄰半導體主要需求市場中、日、韓，且與美國保持良好關係，又因台灣科技業者囊括近乎所有科技產業之中、下游代工，方便台灣半導體業者與下游廠商合作發展，在

技術及創新能力優於國際競爭對手之情形下，間接提升台灣產品與技術之競爭力。依 TSIA 及 IEK 統計預估，2021 年台灣 IC 產業鏈可望持續成長並達到約 3.50 兆新台幣之規模，全球市占率約 25%的佳績(表三)。

半導體產業發展至今，隨技術與市場競爭變革使產業朝扁平化及國際分工發展，惟半導體生產設備造價昂貴，技術高端，使進入門檻高；而無晶圓廠 IC 設計業者不需要龐大之實體資產，投資規模遠小於垂直整合及代工廠商，故進入門檻相對較低，亦有助於業者專攻利基市場，在中國業者積極搶食 IC 設計大餅下，無晶圓廠 IC 設計為目前半導體產業成長之主要動能之一。根據市場研究調查機構 IC insights 研究報告資料統計，近十年來無晶圓廠 IC 設計產業銷售額呈現翻倍成長，銷售額占全球 IC 市場銷售總金額之 32.9%，較 2010 年之 23.7%成長 9.2 個百分點(圖三)。

圖三、無晶圓廠 IC 設計銷售佔全球 IC 銷售市場比重



資料來源：IC Insights, 2020

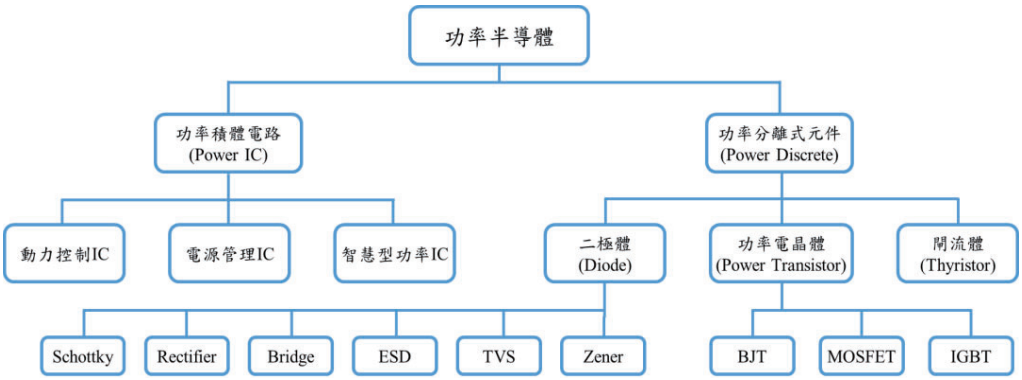
半導體的電子元件尺寸不斷縮小，功率耗損也隨之下降，進而減少裝置之能源需求，不僅提高電子產品之壽命，也降低對環境的傷害。同時，晶片效能及運算速度提昇也使得成本下降，讓一般消費者負擔得起更好的產品。而未來半導體產業之長線趨勢能否維持成長，將取決於傳統半導體產品需求及新興領域之發展程度，傳統產品如智慧型手機、電腦等消費性電子之需求若具有效支撐，且新興人工智慧、車用及物聯網等技術發展逐漸成熟，在中美貿易摩擦趨緩下，預計也將為半導體產業迎來新一輪之成長循環。

B.功率元件市場概況

半導體中之功率半導體(亦稱功率元件)為電子產品之重要部件，主要係對電能進行直流或交流變換、控制、穩定等技術，隨著電力需求增加及節能意識抬頭，下游產品對電能轉換效率、穩定性及高功率等條件提出更複雜之整合需求，而功率元件能夠乘載之電壓範圍較廣，且產品設計彈性高，故與電力使用效率相關的電力電子技術中，越來越受重視。功率半導體包含功率分離式元件與功率積體電路兩類，其中功率分離式元件是將個別功

率元件進行封裝，而功率積體電路是將功率分離式元件與具有驅動、控制、保護、監測功能之 IC 電路整合。功率分離式元件又包含閘流體(Thyristors)、二極體(Diodes)及功率電晶體(Power Transistors)等(表四)，是電能傳輸轉換的關鍵零組件，本公司主要產品 MOSFET 即屬於功率分離式元件中的功率電晶體，主要用做電流開關及電壓控制。

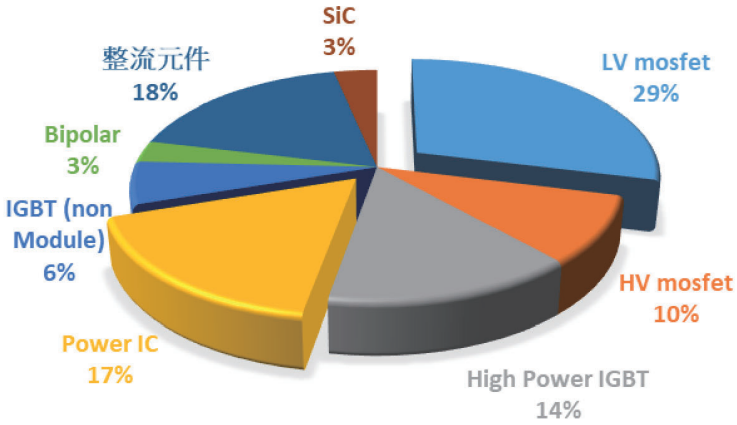
表四、功率半導體產品分類



資料來源：本公司整理

以 2020 年全球功率元件市場銷售佔比推估分析，前三大產品類別將分別為低壓 MOSFET、整流元件及 Power IC，分別佔全球銷售額之 29%、18%及 17%(圖四)；若合併元件類別檢視，則高、低壓 MOSFET 合計即占市場約達 39%，屬功率元件佔比最高之產品別。

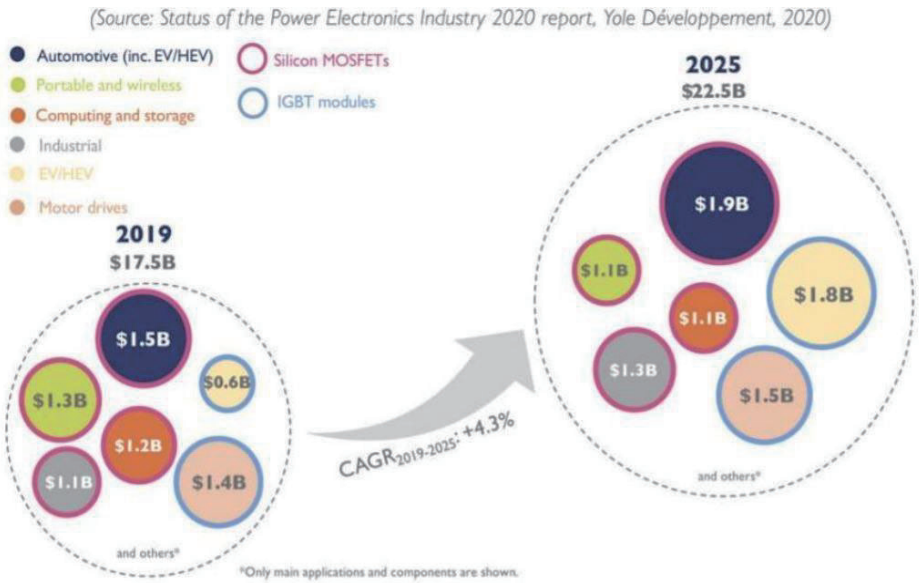
圖四、2020 年全球功率半導體分類銷售占比



資料來源：東芝 Device & Storage；工研院產科國際所 ITIS 研究團隊, 2020

功率半導體之核心技術除結構設計外，在初期材料選擇、中段晶圓製程、及後段封裝測試等部分皆舉足輕重，有鑑於功率半導體之產品周期較長、穩定性高等特點，產品設計更著重於分析材料之物理化學性質及製程，並進行參數調整和性能改良，以製作出符合客戶需求之客製化產品；另因電子產品朝輕、薄、短、小演進，故零件間須頻繁整合以符合未來產品發展趨勢，而客製化產品較公規產品更容易進行元件整合，故為未來功率半導體產品之主要發展特徵。

圖五、2025 年全球功率半導體應用成長預測



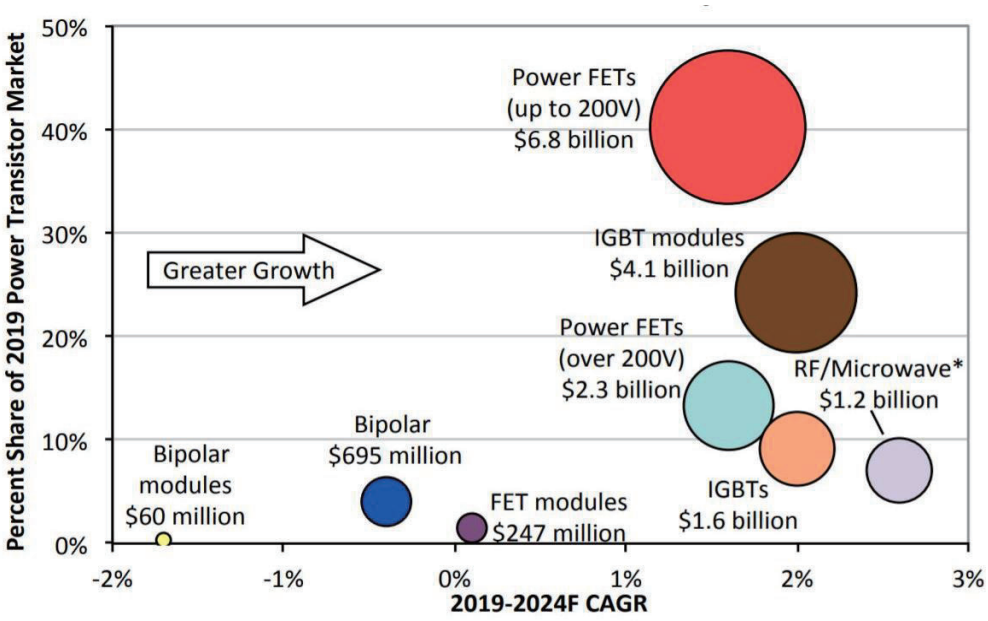
資料來源：法國 Yole Developpement, 2020

功率元件市場成熟且穩健，在技術水平與生產良率持續提升下，以及元件整合使產品應用領域逐漸拓展，主要成長動能除傳統之各式電腦、通訊傳輸及消費性電子等電子製造業需求外，新興應用市場如新能源汽車、太陽能及風電等再生能源、雲端 5G 等亦帶來巨大之需求缺口。根據 Yole Developpement 統計指出，2019 年全球功率半導體市場規模約為 175 億美元，預計於 2025 年將達到 225 億美元，年均成長率為 4.3%(圖五)。若以終端應用分別檢視，電動車、車用電子及工業用之功率半導體成長幅度最大；其中，在各國政府祭出節能政策以減少二氧化碳廢氣排放，直接加速傳統燃油汽車業者向電動車、混合能源車轉型，帶動汽車產業鏈電動化程度提升。除電動引擎、馬達、電池儲能、電源管理及輔助車用電子等新能源車基本必要配備，亦包含電機變頻裝置、電壓轉換穩定、高壓電流輔助驅動裝置、車載充電器(OBC)及油電電控系統等高端汽車功率系統需求，故車用電子及電動車零組件將為功率半導體市場成長之一大動能；另由於對能源使用效率越趨重視，又因功率半導體在工廠自動化、智能製造及節能工具等產業升級過程貢獻卓越，使工業用功率半導體需求同步成長。

功率分離式元件中之功率電晶體，據 IC Insights 之報告指出，因產業鏈轉型及市場變遷使全球功率電晶體銷售量自 2011 年~2015 年上下波動明顯，惟 2016 年起因終端需求回穩而進入穩定成長期。2020 年功率電晶體市場受疫情影響使規模小幅減少至 158 億美元，相較於 2019 年約下滑 7%；但觀察 2020 年下半年疫情趨緩後，因終端需求回溫使庫存水位降低，下游廠商拉貨意願積極，預計將持續至 2021 年，使功率電晶體市場需求有所反彈，IC Insights 預估規模將回升至 169 億美元，成長率為 7%，主要成長動能為射頻、微波及通訊傳輸等 5G 應用板塊，以及電子產品之電源供應及電池能源管理等。預估 2019 年~2024 年，功率電晶體市場平均將有 1.7%

之年複合成長率。

圖六、2019~2024 年全球功率電晶體市場銷售預測

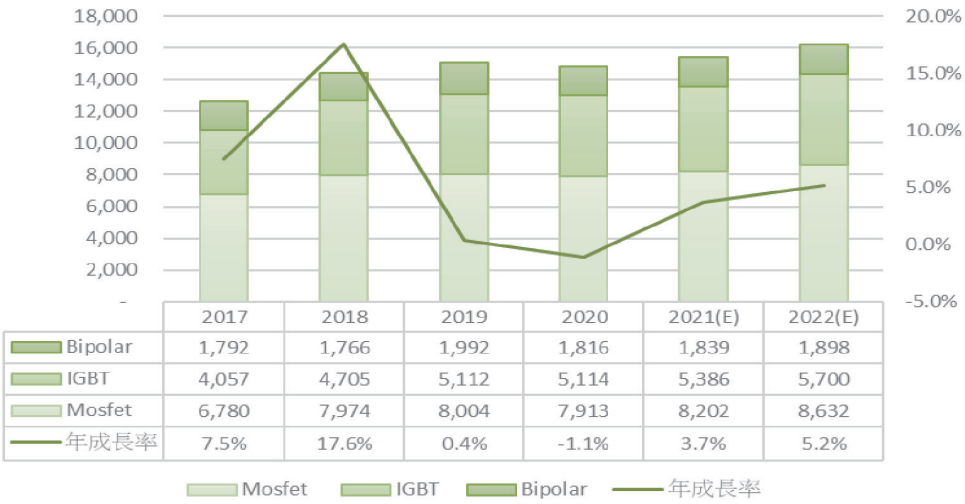


資料來源：IC Insights, 2020

IC Insights 預估在功率電晶體中，MOSFET 仍是市值最高者，且綜合佔比最大，以低壓至 200 伏 MOSFET 為例，銷售額將達 68 億美元(圖七)。相較於其他功率元件，其主要功能為電子裝置之電力轉換與管理，作用為電源開關與訊號放大等。MOSFET 具有導通電阻小、開關損耗低、驅動電路簡單及受熱特性佳等優點，且反應速度快，延遲時間低，使其適用於需要高反應速度，中低電壓與功率承載之產品，如電腦、手機、電源供應器、車用導航、電動交通工具等中端應用之電源控制領域。

圖七、2017~2022 年全球功率電晶體元件市場分類概況

單位：百萬美元



	2017	2018	2019	2020	2021(E)	2022(E)
Bipolar	1,792	1,766	1,992	1,816	1,839	1,898
IGBT	4,057	4,705	5,112	5,114	5,386	5,700
Mosfet	6,780	7,974	8,004	7,913	8,202	8,632
年成長率	7.5%	17.6%	0.4%	-1.1%	3.7%	5.2%

資料來源：WSTS、拓樸產業研究院, 2021

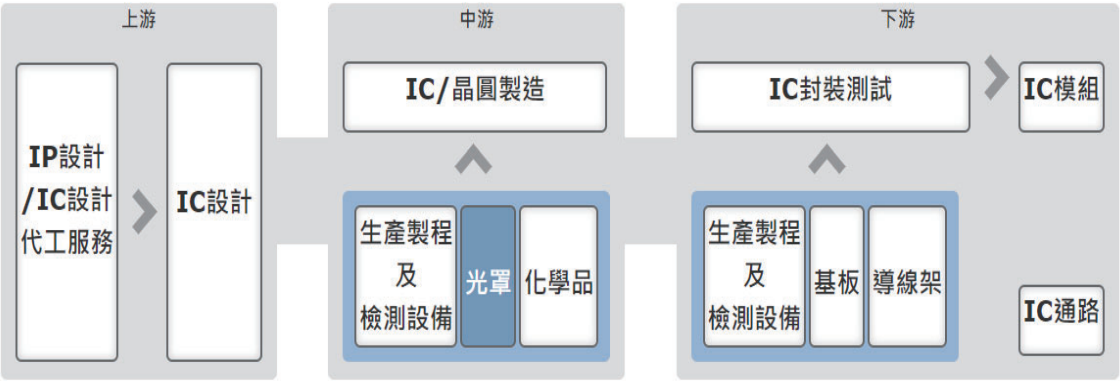
2020 年因新冠肺炎疫情影響終端需求使 MOSFET 市場規模較 2019 年小幅下跌 1.1%，為 7,913 百萬美元(圖八)，在 5G 通訊、物聯網、電動車等應用皆具成長動能，且國際 IDM 大廠提高獲利最豐厚之車用銷售佔比下，造成中低壓 MOSFET 供應缺口；2020 年第四季起由於中美關係緊張且疫情不確定因素增加，下游客戶端擔心產業鏈受缺料問題影響，使 MOSFET 等矽晶圓產品拉貨力道相較以往同期更加強勁，而上游晶圓產能吃緊，連帶影響晶圓代工及封測產能滿載、交期延長，MOSFET 業者亦加大投片力道以滿足供需失衡，進而導致供貨短缺與漲價之循環。WSTS 預估 2021 年及 2022 年 MOSFET 市場產能將持續吃緊，業者調升售價轉嫁成本，再加上新能源、快充、高速運算及自動化等高用電量產品推動市場演進，整體 MOSFET 市場規模將可達到 8,202 百萬美元及 8,632 百萬美元，成長率分別為 3.7%及 5.2%。

MOSFET 產業受惠於人工智慧、汽車電子、電動車等終端需求成長，使國際大廠逐漸供不應求，普遍上調售價，亦吸引中國功率半導體廠商如華潤微、士藍微等積極投入 8 吋與 12 吋晶圓廠的投資，使 MOSFET 產業鏈附加價值提升。在政府祭出優惠政策扶植本土產業，及半導體廠產能陸續開出後將可回復供需平衡，然而中國受到中美貿易戰及美國抵制中興、華為等事件影響，預期 MOSFET 在進行庫存及供貨調整後，仍會受到國產取代進口之政策影響，整體市場規模持續成長。

(2)產業上、中、下游之關聯

半導體產業上游係 IC 設計，中下游依續包括光罩、晶圓製造、封裝、測試及通路銷售等。本公司自行設計或接受客戶委託，完成半導體電路之布局，屬半導體產業鏈中之上游。上游之半導體設計公司設計出製程所需的布局後，接著進行光罩製作，再經晶圓代工廠製造出晶圓半成品。晶圓半成品需經前段測試後再交由封裝廠進行切割與封裝，封裝後的產品得交由專業測試廠進行後段測試，才完成最終產品。茲將 IC 設計產業上、中、下游產業關聯圖列示如下：

圖八 上、中、下游關係圖



資料來源：產業價值鏈資訊平台

我國半導體產業與國際整合元件大廠（IDM）將半導體產業上中下游幾乎一手包辦有所不同，我國半導體產業係將產業鏈中垂直連續的製程，分別專業化為 IC 設計、光罩設計、晶圓代工製造、封裝測試等產業。將資源集中於單一產業的專業分工，又有緊密聯繫的產業聚落，使我國半導體產業在 IC 設計、晶圓代工、IC 封裝產業在國際市場上取得領先地位。

功率半導體元件之終端應用廣泛，在半導體產業中，IC 通路商亦扮演重要角色，協助 IC 設計公司進行銷售，由於我國半導體產業專業分工的模式，使無晶圓廠之半導體設計公司能將製造委由專業晶圓代工廠進行、銷售透過 IC 通路商協助，專心於設計本業，並以效率、彈性及成本優勢快速成長。由於半導體產業上下游關係密切，功率半導體設計公司與委外代工廠商間技術與需求產能上的適切配合，也成為功率半導體設計公司維持穩定經營的重要關鍵。

(3)產品發展趨勢

功率元件產品目前以高功率、高性能、高散熱為技術發展主軸，並朝各元件間整合及微型化為市場發展趨勢。近年來產品應用於能源系統與車用將有大幅成長，材料基礎特性的提升與結構的進化成為兩大關鍵影響因子。在材料基礎特性提升方面，目前市場上朝矽(Si)至碳化矽(SiC)及氮化鎵(GaN)的新材料開發，由於矽之高頻高溫特性不如碳化矽及氮化鎵，因此在因應未來高功率應用的需求，後兩者將逐步取代前者。此外，碳化矽及氮化鎵兩項寬能隙材料，除了可符合高電壓、大電流的要求，也有助於元件微型化。

電子產品在微型化、可攜式的設計趨勢下，內部的半導體元件也朝向外觀小型化發展，且要求多元件整合，包括金氧半功率場效電晶體和蕭特基及保護二極體之整合，驅動電路與功率元件的整合等，以達到節省空間、縮小體積的目的。MOSFET 與 IGBT 等發展成熟的元件，朝向系統級封裝發展，縮短元件間的距離，減少接線，才能降低功耗損失。功率元件朝向新一代結構與製程技術、微型化封裝技術、WLCSP 之開發發展，以更佳之散熱能力與更小的 PCB 板佔用面積，提供現今要求輕薄短小的電子產品應用之最佳方案。

此外，環境保護議題越來越受到全球重視，許多國家也開始訂定相關法令，因此選用環保材料、在產品生產過程中減少環境傷害與汙染、生產過程中提高能源使用效率也成為製造商發展進步的方向。也因此，環保節能、再生能源等議題也成為功率半導體產業未來市場發展的新方向。

(4)競爭情形

國內功率分離式元件產業規模相對較小，其產能及產量遠小於國外大廠如英飛凌、安森美及意法半導體等 IDM 公司，由於品牌知名度相對國際大廠為低，在提升市佔率上較居於劣勢。此外，儘管目前功率分離式元件市場需求量大，但除國外廠商之技術不斷提昇外，中國企業亦積極投資本土功率分離式元件產業，加大投資力度於軟、硬體升級，使不斷有新競爭廠商加入，故產業競爭激烈。

本公司將視市場供需狀況與電子產品發展趨勢，彈性調整銷售方針，另為維持產品之競爭優勢，除提高產品技術、品質、功能及加強客戶售後及客訴服務外，並積極尋找產業鏈合作，提供客戶一站式購足之服務，以擴大產

品之市場佔有率。此外，充分瞭解客戶產品未來之需求，及早積極開發多樣、高附加價值之利基產品，以豐富產品線及提昇未來利潤空間。同時，業務及研發人員亦隨時注意市場變化及客戶需求，進而提早開發新產品，以符合市場需求。

(三)技術及研發概況

(1) 所營業務之技術層次及研究發展

本公司研發團隊的經驗，主要在於溝槽式功率金氧半場效電晶體之半導體製程技術研發與元件設計上。以上技術均需要長期耕耘，關鍵在於經驗累積及團隊合作能力。本公司是大中華地區第一個具有自主性八英吋 0.18um 溝槽式功率金氧半場效電晶體之半導體製程技術開發和元件設計能力。在新產品的規劃上，由於與市場客戶關係良好，能推出市場需要的產品。

使用 0.18um 製程技術設計的 MOSFET 產品，晶胞密度已從 400M/in^{2}增加至 900M/in^2，並朝向 2G/in^{2}發展。由於晶粒面積縮小 30%以上，晶胞密度大幅提升，晶圓可切割晶粒數增加，且完全不影響原產品電器特性；Buried Gate 與 Narrow Trench Width 之創新技術，可降低 Qgd 和 Qgs，使功率金氧半場效電晶體可應用於高速操作頻率之電子系統上；而淺溝槽金氧化電晶體製程技術可使得 Qgd/Qgs 比值更小於 1，可降低電源系統的功率消耗，符合綠色環保需求發展趨勢。

本公司採用最簡化製程技術，生產良率均能保證大於 95%。依客戶應用線路設計之需求，開發功能更優化產品。MSD 專利將 MOSFET、Schottky 與 ESD Diode 三合一，除技術領先外，更符合客戶應用需求。本公司已完成開發量產業界最低內阻產品 40V (Rds(on)=1.0 m 需求及量產 0.7m(RTyp.))，提高效率並減少耗能，已規劃完成 0.13μm 製程技術於未來之產品線上。

基於本公司對於功率電子電力元件累積之經驗及技術、對先進製程的設計能力優勢及與系統廠商長期合作下建立之互動關係，故本公司持續研發新產品、新製程和專利申請。不僅成為下一階段業績成長力道的來源，且能大大的提升產品的品質和利潤。

(2)研究發展人員與其學經歷

單位：人、年

學歷＼年度	112 年底	113 年底	114 年截至 3 月底
碩士(含以上)	9	7	7
大學(專)	41	41	40
大學(專)以下	4	5	5
期末研發人員合計	13	10	10
平均年資	6.17	6.9	7.02

(3)最近五年度每年投入之研發費用

單位：新臺幣千元；%

項目 年度	研發費用(A)	營業收入(B)	比例(A)/(B)
109 年度	37,118	679,670	5.46
110 年度	40,465	1,105,697	3.66
111 年度	50,805	1,098,228	4.63
112 年度	61,427	738,519	8.32
113 年度	83,933	815,074	10.30

(4)最近五年度開發成功之技術或產品：

年度	技術或產品
109 年度	1. 開發出 RTG 40V N channel power MOSFET 2.2mΩ/ package DFN3.3*3.3，NB 鋰電池應用。 2. 開發出 RTG 30V N channel power MOSFET 1.5mΩ/ package DFN3.3*3.3，NB 鋰電池應用。 3. 在第二晶圓廠建立 100V N channel power MOSFET 的製程平台，以達到提升公司晶圓產能的增加及降低成本的優勢。 4. 在第二晶圓廠建立 60V N channel power MOSFET 的製程平台，以達到提升公司晶圓產能的增加及降低成本的優勢。 5. 開發出 CSP 12V N channel power MOSFET 0.65mΩ，智慧型手機鋰電池應用。 6. 開發出 CSP 12V N channel power MOSFET 4.6mΩ，智慧型手機鋰電池應用。 7. 開發出 CSP 20V N channel power MOSFET 23mΩ，TWS 藍芽耳機鋰電池應用。 8. 開發出 CSP 24V N channel power MOSFET 8.2mΩ，智慧型手機鋰電池應用。 9. 開發出 ETG1 plus 新製程平台。 10. 開發出 ETG1 plus 100V N channel power MOSFET 10 mΩ/ package SOP-8 ，Charger、Synchronous Rectification 應用。 11. 開發出 ETG1 plus 100V N channel power MOSFET 8 mΩ/ package SOP-8 ，Charger、Synchronous Rectification 應用。 12. 開發出 ETG1 plus 100V N channel power MOSFET 6 mΩ/ package DFN5*6 ，Charger、Synchronous Rectification 應用。
110 年度	1. 開發出 RTG 30V N channel power MOSFET 2.2mΩ/ package DFN3*3，NB 鋰電池應用。 2. 開發出 CSP 20V N channel power MOSFET 28mΩ，TWS 藍芽耳機鋰電池應用。 3. 開發出 Low Vth 2N7002 ESD2KV MOSFET，NB 應用。
111 年度	1. 開發出 ETG 100V N channel power MOSFET 5.5mΩ/ package LFPAK，PD 快充。 2. 開發出 ETG 100V N channel power MOSFET 5.5mΩ/ package DFN5*6，PD 快充。 3. 開發出 RTG 40V N channel power MOSFET 1.9mΩ/ package LFPAK，PD 快充。 4. 開發出 ETG 100V N channel power MOSFET 6.7mΩ/ package DFN5*6，PD 快充。 5. 開發出 RTG 30V N channel power MOSFET 5.8mΩ/ package DFN3*3，NB Buck-Boost 電路應用。 6. 開發出 RTG 40V N channel power MOSFET 3.4mΩ/ package DFN3*3，NB 鋰電池應用。 7. 開發出 ETG 60V N channel power MOSFET 3.5mΩ/ package LFPAK5*6，PD 快充。
112 年度	1. 開發出 ETG 100V N channel power MOSFET 7.6mΩ/ package TO-252，Adapter。 2. 開發出 ETG 60V N channel power MOSFET 4.3mΩ/ package TO-252，PD 快充。 3. 開發出 ETG 60V N channel power MOSFET 1.9mΩ/ package LFPAK，PD 快充。 4. 開發出 RTG 40V N channel power MOSFET 0.95mΩ/ package LFPAK，PD 快充。 5. 開發出 RTG 30V N channel power MOSFET 1.8mΩ/ package DFN3*3，NB 鋰電池應用。 6. 開發出 ETG 60V N channel power MOSFET 2.9mΩ/ package TO-252，PD 快充。

年度	技術或產品
	7. 開發出 RTG 30V N channel power MOSFET 7.8mΩ/ package DFN3*3，Power tool、Synchronous Rectification 應用。 8. 開發出 RTG 30V N channel power MOSFET 2.0mΩ/ package DFN5*6，PD 快充。
113 年度	1. 開發出 RTG 40V N channel power MOSFET 3.7mΩ/ package DFN3*3，NB 鋰電池應用。 2. 開發出 RTG 30V N channel power MOSFET 1.7mΩ/ package DFN3.3*3.3，NB 鋰電池應用。 3. 開發出 ETG 100V N channel power MOSFET 2.7 mΩ/ package LFPAK，PD 快充。 4. 開發出 ETG 60V N channel power MOSFET 6.5 mΩ/ package LFPAK，PD 快充。 5. 開發出 ETG 100V N channel power MOSFET 9.0 mΩ/ package LFPAK，PD 快充。 6. 開發出 ETG 100V N channel power MOSFET 7.6 mΩ/ package LFPAK，PD 快充。 7. 開發出 RTG 40V N channel power MOSFET 3.1 mΩ/ package LFPAK，PD 快充。 8. 開發出 ETG 100V N channel power MOSFET 3.8 mΩ/ package LFPAK，PD 快充。 9. 開發出 RTG 40V N channel power MOSFET 1.63 mΩ/ package DFN5*6，PD 快充。 10. 開發出 RTG 30V N channel power MOSFET 0.65 mΩ/ package LFPAK，PD 快充。 11. 開發出 RTG 30V N channel power MOSFET 1.4 mΩ/ package TO-220，Power tool、Synchronous Rectification 應用。 12. 開發出 Trench 30 N channel power MOSFET 1.4 mΩ/ package DFN56，AC-IN Ias 119A 應用。 13. 開發出 Trench 30 N channel power MOSFET 0.8 mΩ/ package DFN56，AC-IN Ias 170A 應用。 14. 開發出 STG 30V N channel power MOSFET 1.1 mΩ/ package DFN33，Battery PACK 應用。 15. 開發出 STG 30V N channel power MOSFET 1.8 mΩ/ package DFN33，Battery PACK 應用。 16. 開發出 STG 35V N channel power MOSFET 1.3 mΩ/ package DFN33，Battery PACK 應用。 17. 開發出 STG 35V N channel power MOSFET 1.8 mΩ/ package DFN33，Battery PACK 應用。 18. 開發出 Trench 60V N channel power MOSFET 960mΩ/ package SOT363/SOT23/SOT523/SOT563，switch 應用。 19. 開發出 Trench 30V P channel power MOSFET 2.7 mΩ/ package DFN56，Gaming AC-IN Ias 105A 應用。 20. 開發出 Trench 30V N channel power MOSFET 480 mΩ/ package SOT363/523，small signal 應用。 21. 開發出 Trench 20V N channel power MOSFET 150 mΩ/ package DFN1006/SOT523，small signal 應用。 22. 開發出 Trench 30V P channel power MOSFET 6.5 mΩ/ package DFN33/56，AC-IN 應用。 23. 開發出 Trench 100V N channel power MOSFET 6.5 mΩ/ package TO-252，Power 應用。

(四)長、短期業務發展計畫

為提升本公司之競爭力及因應未來產業發展趨勢，藉由擬定各項短期與長期業務發展計畫以規劃公司未來經營方向。茲就本公司短期及長期業務發展計畫簡要說明如下：

(1)短期業務發展計畫

A.深入了解客戶設計需求，提供良好客戶產品開發技術諮詢。

B.維持既有客戶之技術與售後服務，保持客戶滿意度。

C.加強研發人力資源，以加快新產品開發時程。

D.強化與各代工廠合作關係，並了解磊晶矽晶圓片供貨狀況，以避免供應鏈短缺情形發生。

(2)長期業務發展計畫

A.培養及訓練行銷人員專業素養及產品知識，以拓展客戶與業務範圍。

B.以自有技術為基礎，開發新應用產品，以提高市場佔有率。

C.提供客製化產品，以與客戶緊密結合，提升營收與利潤。

二、市場及產銷概況

1.市場分析

(1)主要商品(服務)之銷售(提供)地區

單位：新臺幣仟元；%

年度 地區別	112 年度		113 年度	
	銷售金額	銷售比例	銷售金額	銷售比例
內　　銷	38,442	5.21	79,121	9.71
外　　銷	700,077	94.79	735,953	90.29
合　　計	738,519	100.00	815,074	100.00

(2)市場佔有率：

公司產品可廣泛應用於各個產業領域，舉凡電腦及週邊設備、通訊類產品、消費性電子產品、車用電子及工業電子等產品。根據中商產業研究院資料指出，全球功率半導體市場規模 2018~2020 年分別約為 391 億美元、404 億美元及 422 億美元，本公司 109~110 年度及 111 年營業收入分別為新臺幣 679,670 千元、1,105,697 千元及 1,098,228 千元，佔全球市佔甚小。然而國際 IDM 大廠逐漸轉往高壓之車用及高端應用研發，釋出中、低壓市場產能，使供給形成缺口，讓國際大廠以外之廠商有切入之機會。

另就國內市場而言，依據經濟部統計處發布國內分離式元件製造業之銷售值統計資料顯示，108~109 年度及 110 年上半年度國內分離式元件製造業之銷售值分別為 140,237,988 千元、137,513,481 千元及 75,702,424 千元，根據本公司之營收規模計算，本公司占各年度國內分離式元件製造業銷售值約 0.46%、0.49%及 0.71%，市佔率亦不高，故本公司在未來仍具有非常高的市場拓展空間。

(3)市場未來之供需情況與成長性：

功率分離式元件市場在電動車、車用電子、工業應用等終端需求帶動下，預期將持續成長，而本公司為供應鏈上游之功率分離式元件設計公司，與下游產品之需求及供給趨勢乃至於更廣泛之全球功率半導體市場息息相關，茲就功率半導體市場之未來供需情形說明如下：

A.供給情形

全球功率半導體市場之供給主要可分為垂直整合(IDM)廠及無廠半導體設計公司製程委外代工等兩種模式，市占率以國際 IDM 廠佔據領先地位，並以歐、美、日系廠商為主，近年變化幅度不大；根據 IHS Markit 統計，全球功率半導體前 10 大廠市占率達 6 成，主要廠商有德國英飛凌(Infineon)、美國安森美(On Semi)及意法半導體(STMicroelectronics)等，分別佔市場銷售佔比分別約 18%、9%及 5%。由於功率半導體市場係一技術及資金密集之產業，且國際大廠佔供應市場之大宗，故其市場策略與營運布局將左右整體市場之供需平衡。而因應電動車、車用電子、工業應用、

5G 通信等高端應用需求，及碳化矽(SiC)及氮化鎵(GaN)等第三代半導體材料演進取得明顯成果，上述大廠已逐漸退出中低壓市場，轉往發展高毛利、進入門檻較高之高壓領域及整合元件產品，使得國際大廠以外之廠商得以切入搶佔。

109 年第四季起，由於中美關係緊張且疫情尚未完全趨緩，下游客戶端擔心產業鏈受缺料問題影響，使矽晶圓產品拉貨力道相較以往同期更加強勁，而上游晶圓產能吃緊，連帶影響晶圓代工及封測產能滿載、交期延長，功率半導體業者亦加大投片力道以滿足供不應求，並調升售價轉嫁成本，使功率半導體業者得以受惠；惟新冠肺炎疫情影響將隨疫苗普及而緩解，且終端需求預計也將持續提升，故其供需情形應將回復正常水平，並隨未來總體經濟市場發展。整體而言，功率半導體市場之供給面並無存在明顯風險。

B.需求情形

功率半導體主要負責對電能進行直流或交流變換、控制及穩定等技術，為電子產品重要且不可或缺之元件，因此，功率元件之應用市場極為廣泛，舉凡消費性電子、工業應用、電力能源、網路通訊及車用等領域，凡需用到電力的產品，皆需要功率元件處理電源形式的轉換。而根據 Yole Developpement 之統計預測，2025 年全球功率半導體市場規模將達到 225 億美元，2019~2025 年複合成長率約 4.3%，除歐美大廠持續擴充高階應用產能及中國業者積極搶進低階市場外，尚有以下幾種因素推動產業需求面成長：

a. 生產技術水平不斷提升

近年來隨著終端應用領域產品的規格要求越來越高，功率半導體研發技術也在市場的推動下不斷向前發展，其中主要包含材料與結構設計及生產技術之革新。材料提升方面，目前市場上功率分離式元件材料以由矽(Si)基底朝碳化矽(SiC)及氮化鎵(GaN)之第三代半導體材料演進，由於矽之高頻高溫之動態參數、性能及穩定性不如碳化矽及氮化鎵，因此在因應未來高功率、高電壓之車用、工業應用與能源管理需求，SiC 及 GaN 將有更大之發展與使用空間，以目前國內外廠商之發展趨勢檢視，SiC 及 GaN 將逐步取代前者成為功率分離式元件之主要材料。

在使用新材料後，物理化學性質提升即增加設計之彈性，規劃出更高功率與相對低耗損之產品線，並且在整合元件需求下，有更多客製化結構設計之空間；而結構設計之革新主要來自業者皆注重研發團隊之培育，使研發及生產技術含量日益提高，亦加促進產業晶圓製造與封裝工藝技術之提升；在國際領先大廠持續挹注資金動能投資生產軟、硬體設備，目前在生產線已普遍採用 8 吋晶圓與 0.18μm 製程技術，不僅提高了生產良率與精度，也提升了產品效能，並間接導致功率半導體產品線與終端需求不斷延伸和拓寬。

b. 新應用領域增加

在產業技術水平不斷提升下，產品規格及效能得到優化，又伴隨近年來興起之 AI、工業自動化、5G、物聯網及新能源車等應用領域，創造新的功率半導體市場。上述應用對電能控制皆有不同程度之需求；再者，由上述領域衍生出之自動駕駛、安控、能源管理、功率傳感、影像分析及儲能充電樁等皆需要功率半導體於結構內部進行電能之控制，因此在新概念下伴隨產生的應用，將成為功率半導體需求之新成長動能。

c. 環保減碳加速產業轉型

依據 2015 年聯合國通過之巴黎協定，期望能共同遏阻全球暖化趨勢，改善空氣品質並將全球平均氣溫升幅控制於攝氏 1.5 度內；為達到此目的，聯合國環境規劃署呼籲全球溫室氣體及碳排放量需要再大幅降低一倍，而各國政府亦設立相應減碳目標，預計於 2050 年前達到零排放成果。其中交通運輸工具之碳排放量佔整體溫室氣體排放量之大宗，且為室外空氣污染之主要原因之一，因此油電混合車、電動車等新能源車成為各國政府積極推動減碳方針的政策，而該等車輛之電池系統、動力系統及車用電子週邊等皆須使用功率半導體進行電能管理，故將挹注整體功率半導體市場之需求。

d. 節能與儲能

有鑑於地球人口逐漸增多，人均可分配資源減少，近年來各國政府積極提倡資源妥善分配，其中包含節約能源。而現今各類電子產品功能性漸增，所需耗用的電力也越來越高，因此節能、儲能及提升電源使用效率成為電子產品的訴求；此亦導致對於電源管理至關重要之功率半導體需求增多。

e. 後疫情時代之新常態

109 年度全球因新冠肺炎疫情肆虐影響，生活型態產生極大的改變，異地備援及在家上班等替代方案形成工作常態，且因人員無法自由進出他國國境，使視訊、影音串流、遠端應用及線上活動等需求配合宅經濟醞釀遠距商機。在疫情未趨緩、疫苗尚未普及前，這些將成為人類生活之新常態，且人類將更重視個人化防疫與精準健康，並強調不間斷營運與虛實整合，造成不同程度之電子化需求，使得功率半導體之應用需求更進一步拓展。

(4)競爭利基：

A.研發團隊實力堅強

本公司持續投入於功率電子元件之研發設計與製造，為國內外少有之同時具備製程研發與元件設計等綜合能力之設計公司。

B.完善的服務及良好的品質

本公司能同時提供予系統廠商控制 IC 及搭配之功率元件最佳方案，使廠商能縮短產品開發時程，另因本公司具備特殊半導體製程設計能力，與晶圓代工廠充分配合適時給予技術支援，加速新產品開發，以利提供予客戶完整之服務。

(5)公司發展遠景之有利、不利因素與因應對策：

A.有利因素

具有自主 0.18um 溝槽式功率金氧半場效電晶體之半導體製程技術，並將晶細胞密度大幅提升從 400M/in 半增加至 900M/in 半，並且完全不影響原產品電器特性。由於 Buried Gate 與 Narrow Trench Width 之創新技術，可降低 Qgs 和 Qgd 使功率金氧半場效電晶體可應用於高速操作頻率之電子系統上。淺溝槽金氧化電晶體製程技術可使得 Qgd/Qgs 比值更小於 1，可降低電源系統的功率消耗，符合綠色環保需求發展趨勢。

B.不利因素

低階產品不斷有新競爭者加入，雖不影響本公司之市佔率，但仍造成價格滑落，降低產品獲利能力。

和國外供應商相較，國內設計公司與國際大廠緊密度仍稍嫌不足，對於第一手技術資訊取得，較為落後。

C.因應對策

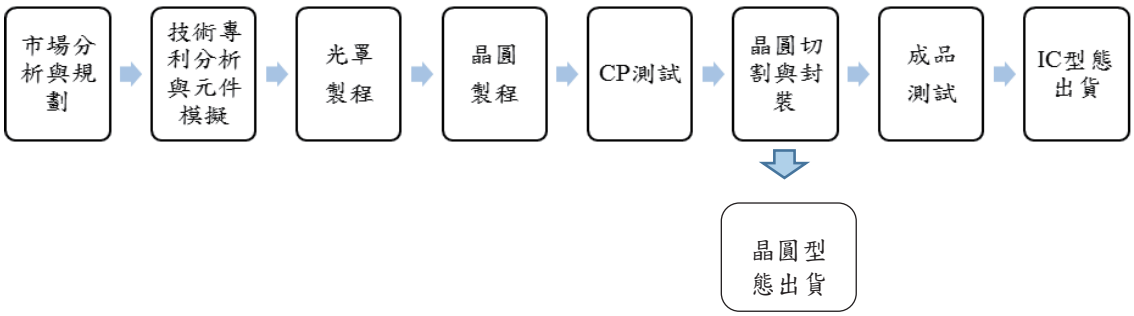
a. 持續研發新製程以有效提升產品特性及降低成本。
b. 持續開發上游供應商以確保產能充足及穩定，得到必要資源。
c. 持續開發高階產品，擺脫低價競爭產品。
d. 致力拓展海外市場及佈局，並與國際大廠直接接觸，取得第一手技術資訊。

2. 主要產品之重要用途及產程

(1)主要產品之重要用途

主要產品	用途或功能
金屬氧化物半導體場效電晶體(MOSFET 及 WAFER)	MOSFET(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor)是一種可以廣泛使用在電路的場效電晶體，利用閘極的偏壓在 MOS 電容的半導體和氧化層介面處吸引電載體形成通道，閘極偏壓改變則通道載體跟著改變，此電晶體為目前數位積體電路使用最多的電晶體，主要功能是用於電路訊號之開關及同步整流，並應用於電腦、行動電話及可攜式產品、車用、照明用之電源控制系統等產品。

(2)產製過程：



3.主要原料供應狀況：

本公司為專業功率半導體分離式元件設計公司，主要原料為磊晶，另因本公司無晶圓廠，主要供應商除磊晶矽晶圓廠之外，尚有晶圓代工廠與晶圓封裝及測試廠。本公司與主要供應商已合作多年，彼此保持關係密切，供貨來源及提供產能均保持穩定，且進貨及代工項目均保持二家或以上之合格廠商，原物料來源及代工產能不虞匱乏。

4.主要進銷貨客戶名單

(1) 最近二年度任一年度中曾占進貨總額百分之十以上之供應商名稱及其進貨金額與比例，並說明其增減變動原因

單位：新臺幣仟元；%

項目	112年度				113年度			
	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率	與發行人之關係
1	P1公司	192,396	41.70	無	P1公司	233,869	36.66	無
2	P8	44,344	9.61	無	P8	117,220	18.38	無
	其他	224,690	48.69	–	其他	286,812	44.96	–
	進貨淨額	461,430	100.00	–	進貨淨額	637,901	100.00	–

變動說明：

本公司生產模式係以訂單生產為主，長期以來與供應商及加工廠保持良好合作關係，最近兩年度進貨金額變化主係對主係隨銷售客戶之訂單及終端市場需求有所增減，113年度因各家業者需求上升，以致訂單大幅增加，故而本公司投產及採購金額較112年度上升。

(2) 最近二年度任一年度中曾占銷貨總額百分之十以上之客戶名稱及其銷貨金額與比例，並說明其增減變動原因

單位：新臺幣仟元；%

項目	112年度				113年度			
	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率	與發行人之關係
1	S13公司	272,046	36.84	無	S13公司	201,751	24.75	無
2	S11-2	160,661	21.75	無	S11-2	180,210	22.11	無
3	S公司	61,677	8.35	無	S公司	94,616	11.61	無
	其他	244,135	33.06	–	其他	338,497	41.53	–
	銷貨淨額	738,519	100.00	–	銷貨淨額	815,074,	100.00	–

變動說明：

本公司113年度銷售給S13公司之金額較112年度減少，主係因客戶調節庫存導致拉貨驟降，故而銷貨金額大幅減少。S公司則因已導入產品之機種陸續量產，故營收漸漸上升。

三、最近二年度及截止年報刊印日止從業員工資料

年度		112年度	113 年度	114 年度截至 3 月 31 日止
員工人數	直接人工	—	—	—
	間接人工	54	53	52
	合計	54	53	52
平均年歲(歲)		40.68	42.22	42.15
平均服務年資(年)		4.83	6.9	7.02
學歷分布比率(%)	博士	1.85	1.89	1.9
	碩士	14.81	11.32	11.5
	大學(專)	75.92	77.36	77
	高中	7.42	9.43	9.6
	高中以下	—	—	—

四、環保支出資訊

1. 依法令規定，應申領污染設施設置許可證或污染排放許可證或應繳納污染防治費用或應設立環保專責單位人員者，其申領、繳納或設立情形之說明：

本公司為專業功率分離式元件設計公司，生產皆委由晶圓代工廠生產及封裝測試加工廠，故不適用。

2. 列示公司有關對防治環境污染主要設備之投資及其用途與可能產生效益：

本公司為專業功率分離式元件設計公司，生產皆委由晶圓代工廠生產及封裝測試加工廠，故不適用。

3. 說明最近二年度及截至年報刊印日止，公司改善環境污染之經過；其有污染糾紛事件者，並應說明其處理經過：

本公司自設立迄今，尚無發生過有污染糾紛事件，故不適用。

4. 說明最近二年度及截至年報刊印日止，公司因污染環境所受損失(包括賠償)，處分之總額,並揭露其未來因應對策(包括改善措施)及可能之支出(包括未採取因應對策可能發生損失、處分及賠償之估計金額，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實)：無。

5. 說明目前污染狀況及其改善對公司盈餘、競爭地位及資本支出之影響及其未來二年度預計之重大環保資本支出：不適用。

五、勞資關係

1. 列示公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施狀況，以及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形

(1)員工福利措施與實施狀況

A. 依「職工福利金條例」規定提撥福利金。

B. 獎金：三節獎金/生日禮金/年中獎金/年終獎金。

C. 保險：勞保、健保及團體保險。

D. 補助：生育、婚喪禮金補助。

E. 活動：員工旅遊及部門聚餐。

(2)員工進修與訓練

本公司於員工服務期間，將提供各項專業培訓，包括職務上所須之專業課程，如半導體產品屬性、功能架構的知識傳授。

(3)退休制度與其實施情形

為使本公司員工在職時能安心工作，並維護其退休後生活，本公司依勞工退休金條例適用新制，每月依政府規定之工資分級表，按月提繳員工每月工資之 6%至勞保局員工個人專戶，並依退休金條例之規定辦理退休相關事宜。

(4)勞資間之協議

本公司定期召開勞資相關行政會議，作為雙方溝通管道，以確保勞資關係和諧。

(5)員工持股信託

本公司於民國 111 年 9 月開辦員工持股信託，除可提升員工向心力及公司經營績效，降低員工流動率外，並可增加員工福利及協助員工長期投資理財規劃。適用對象為本公司任職滿半年之同仁，參加本計畫之同仁由每月薪資中提撥固定金額，同時公司也相對提撥 1:1 之公提金，共同存至專用信託專戶，不僅達到留才目的，更能協助同仁累積財富，規劃未來退休生活。

(6)各項員工權益維護措施情形

本公司一切運作均依勞基法為遵循基準，並確保員工應有之權利。

2. 最近二年度及截至年報刊印日止，公司因勞資糾紛所遭受之損失，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明無法合理估計之事實：無。

六、資通安全管理

(一) 本公司資訊安全管理架構、資訊安全政策、具體管理方案及投入資訊安全管理之資源情況

1. 資訊安全管理架構

資訊安全運作模式採PDCA(Plan-Do-Check-Act)方式管理運作，確保目標之達成且持續調整改善

2. 資訊安全政策

(1) 本公司資訊安全政策，包含以下三個面向:

A. 建立制度規範:訂定公司資訊安全管理制度，規範人員作業行為。

B. 資安科技運用:建置資訊安全管理設備，落實資安管理措施。

C. 人員教育訓練:進行相關資訊安全教育訓練,提升公司全體同仁資通安全意識。

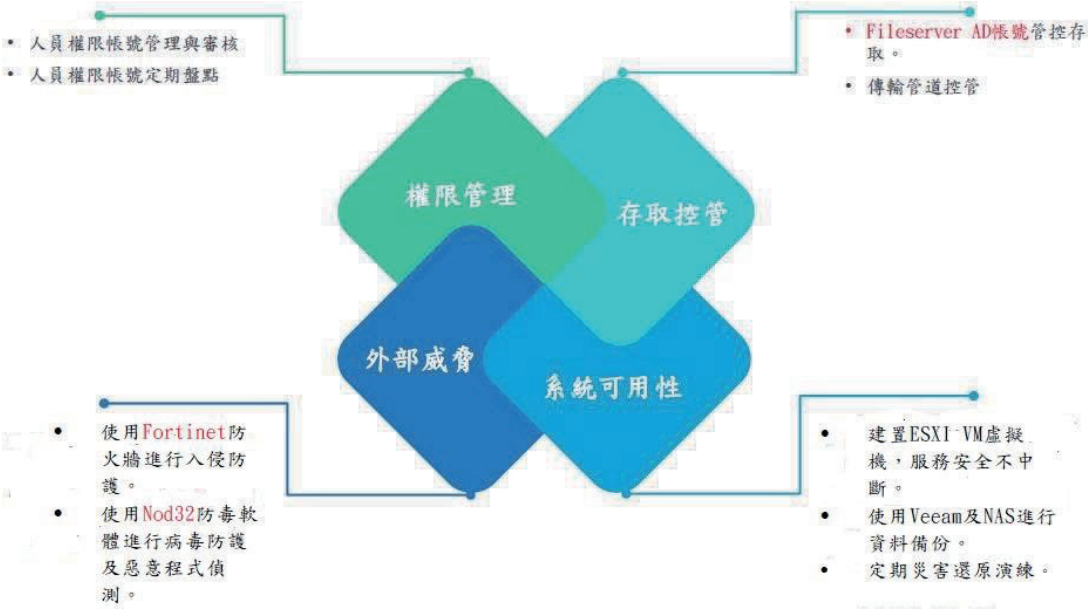
(2) 管理措施說明如下：

A. 建立制度規範：本公司內部訂定多項之資通安全規範及制度，以規範本公司人員資訊安全行為，每年定期檢視相關制度是否符合營運環境變遷，並依實際需求適時調整。每年定期執行內部稽核、會計師資訊查核及不定期資安宣導，以強化本公司機密資料之管理。

B. 資安科技運用：本公司為防範各種外部資安危脅，除採多層式網路架構設計外，更建置各式資安防護系統，以提升整體資訊環境的安全性。

C. 人員教育訓練:本公司定期實施內部人員資訊安全教育訓練，並不定時依實際環境進行資通安全宣導，藉以提升內部人員資安知識及意識。

3. 資通安全具體管理方案



4. 投入資通安全管理之資源

本公司不定期以時事例作為資通安群宣導，為加強資訊安全，民國112年已編列預算，針對公司老舊電腦及資安設備進行汰舊換新，後續預計依實際需求導入相關資安科技工具以強化公司資訊安全。

（二）最近年度及截止年報刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施:無此情形。

七、重要契約

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
房屋租賃契約書	宏匯思源股份有限公司	113/12/27~120/12/26	辦公室租賃	無
房屋租賃契約書	陳建初	111/11/10~116/11/09	倉庫租賃	無
房屋租賃契約	深圳市湖北寶豐實業有限公司	112/12/01~115/11/30	深圳辦公室租賃	無
房屋租賃契約	謝鳳英	113/01/01~115/12/31	深圳員工宿舍租賃	無
銀行融資借款	彰化銀行思源分行	113/12/06~114/11/30	短期信用放款	無
銀行融資借款	兆豐銀行南港分行	113/08/28~114/08/27	短期信用放款	無
銀行融資借款	元大銀行新北區域中心	113/12/12~114/12/12	短期信用放款	無
供貨暨採購合約	P2 公司	111/01/01~114/12/31	採購契約	無
供貨暨採購合約	P4 公司	113/01/01~114/12/31	採購契約	無
產能長期供應協議	P1 公司	111/4/15~117/9/30	採購契約	無

註：本公司因與當事人 P1、P2 及 P4 公司簽訂保密合約，故當事人名稱使用代碼表示。

八、智慧財產權管理計畫與執行成果

本公司為保護研發成果、維持創新能量、強化競爭優勢、提升企業獲利、達成營運目標及落實公司治理，擬定結合公司營運目標與研發資源的智慧財產策略，訂定「專利權申請獎勵辦法」，激勵同仁提出發明申請，專利申請同時結合客戶需求與公司營運策略及智財策略，以此形成企業經營管理模式，將可強化智慧財產之運用，提升企業競爭力並降低侵權風險，以維護公司及股東的最大價值與利益。

智慧財產權保護措施

專利

• 定期專利監控：

充分掌握產業近期的專利核准情形，了解市場發展趨勢。同時委任立揚國際專利

商標事務所協助控管本公司專利及商標。

・定期維護檢討：

檢視已獲證專利之使用情形及與產品的關聯程度，以評估繼續維護之必要性。

・專利觀念宣導：

增強全體員工對專利的認識，及對專利權的尊重，以理解產品開發的合法界線。

商標

・定期維護檢討：

檢視已註冊商標之使用情形，以評估繼續維護的必要性；密切留意公司未來規劃發展，提前進行商標註冊申請。

營業秘密

・資訊安全管理：

本公司所有電腦設備，皆以員工個人帳號密碼進行登入識別，且密碼須定期更換。

・保密觀念宣導：

確保所有員工對營業秘密有所認識，以有效推動法治意識的建立。

執行情形

本公司自 113 年起，定期於每年第四季將智慧財產相關事項提報董事會報告，最近一次提報日期為 113 年 12 月 27 日第八屆第五次董事會。

取得智財清單與成果

- 專利

  截至 113 年底，本公司全球專利獲准總數超過 207 件，目前有效之專利共 118 件，包含台灣 11 件、中國 19 件、美國 85 件、歐盟 1 件、日本 1 件、韓國 1 件。

- 商標

  截至 113 年底，本公司擁有 21 件商標，商標佈局地主要包含台灣、韓國及中國大陸。

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況-合併

單位：新臺幣仟元；%

項目＼年度	112年度	113年度	差異	
			增(減)金額	%
流動資產	690,541	669,719	-20,822	-3.02
不動產、廠房及設備	23,632	16.,962	-6,670	-28.22
使用權資產	14,458	55,785	41,327	285.84
無形資產	4,629	3,378	-1,251	-27.03
其他資產	126,517	76,114	-50,403	-39.84
資產總額	859,777	821,958	-37,819	-4.40
流動負債	106,665	198,857	92,192	86.43
非流動負債	11,278	48,549	37,271	330.48
負債總額	117,943	247,406	129,463	109.77
股本	338,908	338,908	0	0.00
資本公積	359,238	318,896	-40,342	-11.23
保留盈餘	75,707	-27,702	-103,409	-136.59
庫藏股	-31,902	-55478	-23,576	73.90
權益總額	741,834	574,552	-167,282	-22.55

重大變動說明：(變動比率達 20%以上且變動金額達 1,000 萬元以上)

1. 流動負債、非流動負債及負債總額：主要係生產活動上升，故應付帳款、存入保證金及其他應付款餘額增加所致。
2. 保留盈餘：113 年度有盈餘分配所致。
3. 其他資產：預付貨款等減少所致。
4. 使用權資產：房屋及運輸設備增添所致。
5. 庫藏股：113 年度買回庫藏股所致。

財務狀況-個體

單位：新臺幣仟元；%

項目＼年度	112年度	113年度	差異	
			增(減)金額	%
流動資產	689,367	668,463	-20,904	-3.03%
不動產、廠房及設備	23,632	16,962	-6,670	-28.22%
使用權資產	12,122	53,066	40,944	337.77%
無形資產	4,629	3,378	-1,251	-27.03%
其他資產	128,182	77,003	-51,179	-39.93%
資產總額	857,932	818,872	-39,060	-4.55%
流動負債	106,373	197,116	90,743	85.31%
非流動負債	9,725	47,204	37,479	385.39%
負債總額	116,098	244,320	128,222	110.44%
股本	338,908	338,908	0	0.00%
資本公積	359,238	318,896	-40,342	-11.23%
保留盈餘	75,707	-27,702	-103,409	-136.59%
庫藏股	-31,902	-55,478	-23,576	73.90%
權益總額	741,834	574,552	-167,282	-22.55%

重大變動說明：(變動比率達 20%以上且變動金額達 1,000 萬元以上)

1. 流動負債、非流動負債及負債總額：主要係生產活動上升，故應付帳款、存入保證金及其他應付款餘額增加所致。
2. 保留盈餘：113 年度有盈餘分配所致。
3. 其他資產：預付貨款等減少所致。
4. 使用權資產：房屋及運輸設備增添所致。
5. 庫藏股：113 年度買回庫藏股所致。

二、財務績效

1. 最近二年度營業收入、營業純益及稅前純益重大變動之主要原因經營結果比較分析表-合併報表

單位：新臺幣仟元

年度 項目	112年度	113年度	差異	
			增(減)金額	%
營業收入	738,519	815,074	76,555	10.37%
營業成本	537,536	621,139	83,603	15.55%
營業毛利	200,983	193,935	-7,048	-3.51%
營業費用	200,212	314,587	114,375	57.13%
營業淨利	771	(120,652)	-121,423	-15748.77%
營業外收入及支出	10,517	45,617	35,100	333.75%
繼續營業部門稅前淨利	11,288	(75,035)	-86,323	-764.73%
所得稅費用	4,785	2,035	-2,750	-57.47%
繼續營業部門稅後淨利	6,503	(77,070)	-83,573	-1285.15%
其他綜合損益	(53)	45	98	-184.91%
本期綜合損益總額	6,450	(77,025)	-83,475	-1294.19%

重大變動說明：(變動比率達 20%以上且變動金額達 1,000 萬元以上)

1. 營業費用：係 113 年度因勞務費用大幅增加，致使營業淨利大幅下滑所致。
2. 營業外收入及支出：因兌換利益下降所致。
3. 繼續營業部門稅前淨利及繼續營業部門稅後淨利：因營業費用大幅增加，致使繼續營業部門稅前淨利及繼續營業部門稅後淨利均大幅下滑。

最近二年度營業收入、營業純益及稅前純益重大變動之主要原因經營結果比較分析表-個體報表

單位：新臺幣仟元

年度 項目	112年度	113年度	差異	
			增(減)金額	%
營業收入	738,509	814,460	75,951	10.28%
營業成本	536,670	618,621	81,951	15.27%
營業毛利	201,839	195,839	-6,000	-2.97%
營業費用	195,018	315,722	120,704	61.89%
營業淨利	6,821	(119,883)	-126,704	-1857.56%
營業外收入及支出	4,457	44,848	40,391	906.24%
繼續營業部門稅前淨利	11,278	(75,035)	-86,313	-765.32%
所得稅費用	4,775	2,035	-2,740	-57.38%
繼續營業部門稅後淨利	6,503	(77,070)	-83,573	-1285.15%
其他綜合損益	(53)	45	98	-184.91%
本期綜合損益總額	6,450	(77,025)	-83,475	-1294.19%

重大變動說明：(變動比率達 20%以上且變動金額達 1,000 萬元以上)

1. 營業費用：係 113 年度因勞務費用大幅增加，致使營業淨利大幅下滑所致。
2. 營業外收入及支出：因兌換利益下降所致。
3. 繼續營業部門稅前淨利及繼續營業部門稅後淨利：因營業費用大幅增加，致使繼續營業部門稅前淨利及繼續營業部門稅後淨利均大幅下滑。

2. 預期未來一年度銷售數量及其依據與本公司預期銷售數量得以持續成長或衰退之主要影響因素：

本公司114年之預期銷售數量乃依據以前年度之銷售及購料情形、委外加工及公司人力分配情況等，並預估產業經濟環境及景氣狀況。本公司主要營業項目未有重大變化，在市場面致力研發市場主流電子產品及掌握市場脈動，除此之外，更著重於研發人員專業提升，以增加產業競爭力，預計本公司未來年度之營業額，應可穩定成長。

三、現金流量

1.最近年度(113年度)現金流量變動情形分析-合併

單位：新臺幣仟元

項目 \ 年度	112 年度	113 年度	增減比例（%）
期初現金餘額	339,947	230,931	-32.07%
營業活動之淨現金流入(流出)	2,735	(6,169)	-325.56%
投資活動之淨現金流入(流出)	(8,274)	(8,355)	0.98%
籌資活動之淨現金流入(流出)	(103,477)	(72,055)	-30.37%
期末現金餘額	230,931	144,352	-37.49%
重大變動說明：(變動比率達20%以上且變動金額達1,000萬元以上) 1. 籌資活動：113 年度短期借款增加，產生籌資活動之淨現金流入。			

最近年度(113年度)現金流量變動情形分析-個體

單位：新臺幣仟元

項目 \ 年度	112 年度	113 年度	增減比例（%）
期初現金餘額	332,627	230,372	-30.74%
營業活動之淨現金流入(流出)	8,052	(7,185)	-189.23%
投資活動之淨現金流入(流出)	(8,274)	(8,355)	0.98%
籌資活動之淨現金流入(流出)	(102,033)	(70,750)	-30.66%
期末現金餘額	230,372	144,082	-37.46%
重大變動說明：(變動比率達20%以上且變動金額達1,000萬元以上) 1. 籌資活動：113 年度短期借款增加，產生籌資活動之淨現金流入。			

2.流動性不足之改善計畫：本公司未有現金流動性不足之情形。

3.未來一年(114年度)現金流動性分析

本公司目前營運資金尚屬充裕，預期未來一年現金流動性佳，並無現金不足額之情形。

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：無。

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫：

1.轉投資政策：

本公司衡量營運狀況，業經 110 年 10 月 29 日董事會通過在中國設立子公司，資本額人民幣 200 萬元，以提升本公司於中國大陸之營運及服務客戶功能，及規範客戶收款及訂金之收取，強化中國大陸地區之業務拓展，並取代深圳代表處。本公司已於 110 年 12 月向中國主管機關提出申請，中國子公司「力仕半導體（深圳）有限公司」業已註冊並完成注資及登記程序。

對轉投資事業之管理及控制已訂定「取得或處分資產處理程序」，以便未來掌握轉投資事業之財務、業務狀況；另於內部控制制度中訂定「對子公司之監督與管理辦法」等相關規範，以便督促各子公司針對重大財務、業務事項訂定相關作業程序，並監督其依法執行或辦理，建立子公司營運風險管理機制，以發揮最大之經營績效。

2.轉投資獲利或虧損之主要原因及改善計畫：

A. 本公司 112 年度及 113 年度分別認列投資損失 6,060 千元及 820 千元，主要係中國市場競爭廠商眾多且低價搶單情形嚴重，以致轉投資虧損。

B. 本公司將調整子公司所屬客戶之產品組合，將低技術門檻且低毛利率產品逐步汰換成中、高階產品，避開殺價競爭市場，以使子公司能逐漸轉虧為盈。

3.未來一年投資計畫：無。

六、風險管理及評估

1.利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施

(1)最近年度及截至年報刊印日止利率變動對公司損益之影響及未來因應措施

A.影響：

本公司 112 年度及 113 年度利息支出金額分別為 358 千元及 401 千元，分別占各該年度稅前淨利比重分別為-3.17%及 0.53%，本公司現金部位相當充裕，所謂利息支出均屬與金融機構往來配合業務，金額甚低，佔稅前淨利金額比例並不重大，故利率變動對本公司影響尚屬有限，112 年度比重較高主要係稅前淨利巨幅下降，致使利息支出金額不高，但占比卻較前一年度提升。

B.未來因應措施：

為有效降低利率變動對獲利之影響，除財會部門隨時注意利率走勢外，並與銀行端維持良好關係，以取得較優利率。

(2)最近年度及截至年報刊印日止匯率變動對公司損益之影響及未來因應措施

A.影響：

本公司之銷售地區主要在台灣與中國大陸，多以美金為計價幣別，而原料及晶圓代工亦以美金計價付款，因此部分外幣於應收、應付帳款相互沖抵可產生自然避險效果，惟仍有外幣淨資產部位產生匯兌損益，故匯率波動

對本公司獲利仍有一定之影響，本公司 113 年度產生兌換利益為 25,379 千元，占稅前純益之比例為 33.82%，主係受到台幣大幅升降所致，然隨著本公司營運規模之成長，匯率變動對本公司之獲利影響應逐漸下降。

B.未來因應措施：

1. 本公司採取自然避險策略，運用進銷貨產生之外幣應收付帳款，以相同幣別互抵，以降低匯兌風險。
2. 本公司財務部與往來銀行保持密切聯繫，瞭解匯率市場相關訊息與市場變化，適時提供予相關主管及業務與採購，以為決策之依據，同時並適當調整外幣帳戶比重，以減少外幣匯率風險。
3. 依匯率變動情形調整外幣存款部位，如有需要，將依本公司「取得或處分資產處理程序」之規定，由權責主管採取適當之避險措施，以規避匯率波動之風險。

(3)最近年度及截至年報刊印日止通貨膨脹對公司損益之影響及未來因應措施

本公司並無因受通貨膨脹而有重大影響之情形，且本公司對客戶及廠商之報價，以市場之機動調整者居多，且主要原料係向國內外等廠商採購，藉由分散供應商降低通貨膨脹對本公司之影響。

2.從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施：

本公司一向秉持專注本業及務實原則經營事業，財務政策以穩健保守為原則，截至年報刊印日止，本公司並無從事高風險、高槓桿之投資，亦無從事資金貸與他人、背書保證及投資衍生性商品交易之情事。未來若考量財務業務需要有從事資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之必要，將依本公司訂定之「背書保證及資金貸與他人作業程序」及「取得或處分資產處理程序」相關辦法辦理。

3.未來年度研發計劃及預計投入之研發費用：

(1)未來研發計畫：

A.以矽材料發展的 Power MOSFET 產品，中、低壓產品(20~200V)以 Split Gate 的架構，將專利結構 ETG-1 、ETG-2 及 FTG 的特性加以優化，達到產品的更極致的效能。

B.在高壓產品(300V 以上)，將採用具有較傳統結構優異(低約 70%)的導通電阻的超結接面(Super Junction)來做產品開發，約可再降低一半左右的導通電阻。

C.逐步提升產品的靜電防護能力(ESD)，目前最高等級為 2kV，將會開始針對 4kV 的產品做開發，以期進入汽車高品質及高靜電防護的市場。

D.依照產品的要求，進行不同的打線及散熱設計，並會與驅動 IC 設計同業合作，進行模組的開發，以進入更高毛利及穩定的市場。

(2)預計投入研發費用：

本公司將視營運規模及市場潮流趨勢，依照本公司專案計畫進行，持續投入產品及技術研發，持續保持研發領先地位。本公司預計每年投入營業額的 3%~7%作為研發經費，並視營運狀況隨時調整之。

4.國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司日常營運均遵照國內外相關法令規定辦理，並隨時注意國內外政策發展趨勢及法規變動情形，蒐集相關資訊提供經營階層決策參考，以調整本公司相關營運策略。本公司將隨時注意各國政府對本公司所屬產業推行之重要政策及法令規定，採取適當經營策略，同時開發符合產業之新技術及產品，以擴展市場版圖。

最近年度及截至公開發行說明書刊印日止，本公司並未受到國內外重要政策及法律變動而對本公司財務業務產生重大影響之情形。

5.科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司主要產品係科技產品中基本且不可或缺的材料與零組件，且隨技術進步亦積極不斷研發新規格的產品，以確保市場競爭優勢，同時掌握產業動態及同業市場訊息，並評估其對公司營運之影響後作相對應之調整，以開發符合市場及客戶需求的新產品，並採行穩健的財務管理策略，以保有市場競爭力，故最近年度及截至公開發行說明書刊印日止，尚無因重要科技改變及產業變化而對本公司財務業務產生重大影響之情事。

6.企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司自成立以來便以員工為導向積極強化內部管理，提升品質及效率，善盡企業社會責任，並遵守法令規定，若有影響企業形象或違反法令之情形，將隨即擬定對策，截至年報刊印日止，並無企業形象改變造成企業危機或需進行管理之情事。

7.進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：

本公司最近年度及截至年報刊印日止，並無進行併購其他公司之計畫，將來若有進行併購計畫時，將依據相關法令之規定，秉持審慎評估之態度，考量合併是否能為公司帶來具體綜效，以確實保障公司利益及股東權益。本公司目前尚無進行併購計劃。

8.擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：

本公司最近年度及截至年報刊印日止，並未有進行擴充廠房之計畫，未來如有擴充廠房計畫時，將進行審慎評估並依據相關法令及內部控制制度之規定辦理。

9.進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

(1)銷貨集中所面臨之風險

本公司近年業務拓展有成，並與客戶維持良好關係，112 及 113 年度本公司前十大銷售客戶佔本公司銷貨淨額分別為 82.10%及 81.40%，主係因本公司之下游銷售客戶為大型封裝廠和通路商，透過銷售客戶建立之廣佈國內外之客戶服務網，可快速拓展本公司產品之市占率，不僅有利本公司營業規模及獲利成長，且可專注於研發，提高產品競爭力，並減少管理行銷成本，而本公司亦持續積極開發新客戶，拓展新市場，以期分散經營風險，故本公司應可有效控制銷貨集中之風險。

(2)進貨集中所面臨之風險

本公司為專業 MOSFET 設計公司，台灣半導體產業鏈中，從設計、晶圓代工、封裝及測試等專業分工已趨於成熟，上下游廠商垂直分工是半導體產業一大特色，本公司並無自有之晶圓廠，故委由其他專業之加工廠進行晶圓代工、封裝及測試，惟基於製程技術、品質良率、技術保密性及交期穩定性等各項因素考量，僅選擇固定供應商並保持長期合作關係，此為國內之行業特性。本公司配合之供應商多年來合作關係穩固，其生產品質及交期等亦符合本公司要求，本公司亦積極開發新的供應商，以降低進貨集中之風險。

10.董事或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施：

最近年度及截至年報刊印日止，本公司無董事或持股超過百分之十之大股

東股權之大量移轉之情形。

11.經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：

截止年報刊印日止，本公司並無經營權改變之情事發生。

12.訴訟或非訟事件，應列明公司及公司董事、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及截至年報刊印日止之處理情形：

(1).公司最近二年度及截至年報刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及目前處理情形：

本公司於 111 年發現華碩電腦(股)公司銷售於美國之筆記型電腦內，有侵犯本公司美國專利(專利號分別為 US 7,629,634 及 US 7,812,409)之零組件，經本公司發出律師函無果，故於 111 年在美國對其提起專利侵權訴訟。

美國德州東區聯邦法院陪審團於美國時間 114 年 1 月 13 日判決本公司勝訴，被告華碩電腦(股)公司應賠償本公司美金 1,050 萬元。

(2).公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司，最近二年度及截至年報刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者：無。

(3).公司董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之大股東，最近二年度及截至年報刊印日止發生證券交易法第一百五十七條規定情事及公司目前辦理情形：無。

13.公司董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之大股東最近二年度及截至年報刊印日止，如有發生財務週轉困難或喪失債信情事，應列明其對公司財務狀況之影響：無。

14.發行人於最近一會計年度或申請上櫃會計年度內，符合會計師查核簽證財務報表規則第二條之一第二項重要子公司標準之一者，或推薦證券商認為對發行人財務報告有重大影響者，應增列其風險事項說明：無。

15. 其他重要風險及因應措施：

資安風險評估分析及因應措施

本公司資訊安全風險管理機制如下：

(1)資訊安全政策制訂：

依施政目標考量，進行資訊安全風險評估，並制訂資訊安全政策，確定各項資訊作業安全需求，再據以採行適當及充足的資訊安全措施，確保公司的資訊蒐集、處理、傳送、儲存及流通之安全，以供全體員工遵循。

(2)資訊安全之管理：

I. 系統實體與環境安全管理：

加強機房門禁管理、防火措施、電力及防護措施，以確保系統正常運作。

II. 網路、通訊與操作管理：

架設防火牆(Firewall)及防毒軟體以加強內部資訊管理系統之安全控管，以

確保與外界網路連接時及電子郵件或其它電子方式傳送之控管。

III. 系統存取控制：

確保資料輸入及輸出之正確性及完整性，並建立資料庫及檔案管理機制。

IV. 資通安全檢查之控制：

制訂資料庫以及系統檔案等重要資料備份設備及電腦媒體運送及傳輸過程，應有妥善的安全措施電腦媒體運送及傳輸過程，應有妥善的安全措施。

(3)資訊安全管理與檢討：

I. 制訂對資安事件的預防、演訓及災變處理措施，並每年排定資訊災變演練計劃及針對演練結果加以檢討以利修改相關管理辦法。

II. 資訊安全稽核業務，應遵照公司資訊安全相關管理規定，由專責單位依據資訊安全稽核計畫辦理，並製作查核報告呈報實施成效。

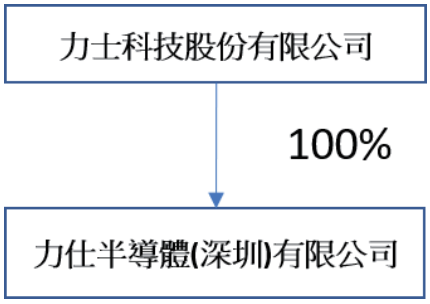
本公司最近年度截至年報刊印日止，未發生影響公司營運之重大資安事件。

七、其他重要事項：無。

陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料

1. 關係企業組織圖：



2. 關係企業基本資料：

企業名稱	力仕半導體(深圳)有限公司
設立日期	2021/11/30
地 址	深圳市罗湖区桂园街道人民桥社区宝安南路1054号湖北宝丰大11层1101室
實收資本額	人民幣200萬元
主要營業或生產項目	电力电子元器件销售；集成电路芯片及产品销售；半导体分立器件销售；电子产品销售；人工智能硬件销售；新能源原动设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；销售代理；矿山机械销售；发电机及发电机组销售；新能源汽车生产测试设备销售；软件销售；集成电路销售。

3. 推定為有控制與從屬關係者其相同股東資料：不適用。

4. 整體關係企業經營業務所涵蓋之行業：不適用。

5. 各關係企業董事、監察人及總經理資料：不適用。

6. 關係企業營運狀況：於113年佣金金額為USD293,625.51。

7. 關係企業合併報表：請參閱合併財務報告。

8. 關係企業報告書：不適用。

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：不適用。

三、其他必要補充說明事項：無。

柒、最近年度及截至年報刊印日止，如發生本法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項，亦應逐項載明：無。

力士科技股份有限公司

董事長：鍾明道

總經理：鍾明道